



UNITED STATES CONTINUING UTILITY PATENT APPLICATION
under 37 C.F.R. § 1.53(b)

Page 1

Atty. Docket No. 00629.00002

USPTO
09/12/00
JC715 U.S. PTO
09/12/00

Assistant Commissioner of Patents
Box Patent Applications
Washington, D.C. 20231

Enclosed herewith is a continuing patent application and the following papers:

First Named Inventor (or application identifier): Akihiro NITAYAMA

Title of Invention: SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE AND METHOD OF MANUFACTURING
THE SAME

- Continuation
- Divisional
- Continuation-in-Part

of prior application No. 08/982,478, filed December 2, 1997

1. English and Japanese specification 55 pages (including specification, claims, abstract) / 17 claims (8 independent)
2. Declaration/Power of Attorney:
 - Copy from Prior Application (for continuation or divisional application)
 - Newly Executed Declaration (for CIP application)
 - Deferred under 37 C.F.R. § 1.53(f)
3. Incorporation by Reference - The entire disclosure of the prior application, from which a copy of the oath or declaration is supplied is considered as being part of the disclosure of the accompanying application and is hereby incorporated by reference therein
4. 54 Distinct sheets of Formal Informal Drawings (Fig. 1A-33)
5. Preliminary Amendment
6. Information Disclosure Statement
 - Form 1449
 - A copy of each cited prior art reference
7. Assignment
 - Assignment with Cover Sheet attached
 - Assignment filed in prior application. Application assigned to: **Kabushiki Kaisha Toshiba**

UNITED STATES CONTINUING UTILITY PATENT APPLICATION

under 37 C.F.R. § 1.53(b)

Page 2

Atty. Docket No. 00629.00002

7. Priority is hereby claimed under 35 U.S.C. § 119 based upon the following application(s):

Country	Application Number	Date of Filing (day, month, year)

8. Priority document(s)
9. Small Entity Statement
 Small Entity Statement was filed in prior application, Small Entity Status is still proper and desired
 is attached
 is no longer claimed
10. Microfiche Computer Program (Appendix)
11. Nucleotide and/or Amino Acid Sequence Submission
 Computer Readable Copy
 Paper Copy (identical to computer copy)
 Statement verifying identity of above copies
12. Calculation of Fees:

FEES FOR	EXCESS CLAIMS	FEE	AMOUNT DUE
Basic Filing Fee (37 C.F.R. § 1.16(a))			\$690.00
Total Claims in Excess of 20 (37 C.F.R. § 1.16(c))	0	18.00	\$0.00
Independent Claims in Excess of 3 (37 C.F.R. § 1.16(b))	5	78.00	\$390.00
Multiple Dependent Claims (37 C.F.R. § 1.16(d))	0	260.00	\$0.00
Subtotal - Filing Fee Due			\$1,080.00
	MULTIPLY BY		
Reduction by 50%, if Small Entity (37 C.F.R. §§ 1.9, 1.27, 1.28)	0		\$0.00
TOTAL FILING FEE DUE			\$1,080.00
Assignment Recordation Fee (if applicable) (37 C.F.R. § 1.21(h))	0	40.00	\$0.00
GRAND TOTAL DUE			\$1,080.00

UNITED STATES CONTINUING UTILITY PATENT APPLICATION
under 37 C.F.R. § 1.53(b)

Page 3

Atty. Docket No. 00629.00002

13. PAYMENT is:

- included in the amount of the GRAND TOTAL by our enclosed check. A general authorization under 37 C.F.R. § 1.25(b), second sentence, is hereby given to credit or debit our Deposit Account No. 19-0733 for the instant filing and for any other fees during the pendency of this application under 37 C.F.R. §§ 1.16, 1.17 and 1.18
- not included, but deferred under 37 C.F.R. § 1.53(f).

14. All correspondence for the attached application should be directed to:

Banner & Witcoff, Ltd.
1001 G Street, N.W.
Washington, D.C. 20001-4597
Telephone: (202) 508-9100
Facsimile: (202) 508-9299
PTO Customer No. 22907

15. Other: _____

Date: September 12, 2000

By: 
Joseph M. Potenza
Reg. No. 28,175

b#38-800

SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE
AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME
[CIP (Continuation-In-Part)]

5 CROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATION

This is a Continuation-In-Part application of U.S. Patent Application Serial No. 08/982,478, filed December 2, 1997, the entire contents of which are incorporated herein by reference.

10 TECHNICAL FIELD

The present invention generally relates to semiconductor memory devices and methods of manufacturing the same and, more particularly, to highly integrated dynamic memory devices and methods 15 of manufacturing the same.

DESCRIPTION OF THE RELATED ART

Figures 1A and 1B illustrate a memory cell having a MINT architecture and a 0.25 micron design rule which is usable in a 256 Mbit dynamic random access memory 20 (DRAM) device. Specifically, Figure 1A is a top-down view of the trench memory cell and Figure 1B is a cross-sectional view taken along line A-A' of Figure 1A. DRAM cell 550 includes a trench capacitor 555 and a MOS transfer gate 560. Trench capacitor 555 includes a 25 first N+ type polycrystalline silicon fill 565, a second polycrystalline silicon fill 567, and a collar oxide 571. Transfer gate 560 includes N-type

2029859 - 6 - 2029859

source/drain and drain/source regions 573 and 574 formed in P-type well 575 and a WSix/polycrystalline silicon gate 577 insulatively spaced from the channel region between source/drain region 573 and drain/source region 574. A bit line contact 579 formed in an opening in an insulating layer 80 (of BPSG, for example) and in insulating layer 578 (of silicon nitride, for example) electrically connects source/drain region 573 to bit line 581. A shallow trench isolation (STI) structure 590 electrically isolates DRAM cell 550 from an adjacent DRAM cell and passing word line 592. Passing word line 592 has a WSix/polycrystalline silicon structure. A dielectric layer 587 is formed on bit line 581 and aluminum wirings 589 are formed on dielectric layer 587. One of the aluminum wirings 589 is connected to bit line 581 by a contact stud 591 of tungsten, for example. A diffusion region 583 electrically connects third polycrystalline silicon fill 569 and drain/source region 574 of MOS transfer gate 560. This diffusion region is formed by outdiffusing dopants from the highly doped polycrystalline silicon fill in the storage trench into P-well 575. Diffusion region 583 and third polycrystalline silicon fill 569 constitute a buried strap for connecting trench capacitor 555 to transfer gate 560.

While the memory cell structure of Figures 1A and

1B has been successfully applied to 256 Mbit DRAM devices, certain problems can adversely impact the manufacturing yield of such devices. With reference to Figure 2A, the outdiffusion of dopants to form diffusion region 583 must be carefully controlled. If the dopants diffuse too far into the semiconductor substrate, the operation of transfer gate 550 can be adversely affected. This, for example, places certain limitations on the thermal processes used in the manufacturing process since long, high temperature processes will cause a greater outdiffusion of the dopants. In addition, various crystal defects can be generated at the intersection of the active area (transfer gate) and the deep trench. For example, various oxidation processes during the manufacturing process can cause expansion of the collar oxide 571. This expansion can lead to dislocations in the silicon. In addition to contributing to the adverse operation of the transfer gate, such dislocations can cause junction leakage from the buried strap diffusion layer 583. Still further, as shown in Figure 2B, in some cases, there can be a discontinuity between the cell array junction and the buried strap caused by ion implantation shadowing due to a passing word line.

Problems are also associated with the scaling-down of the DRAM cell of Figures 1A and 1B to form more highly integrated memory devices (e.g., 1 Gbit and 4

Gbit DRAM devices). In particular, the scaled-down memory cell must nonetheless provide a capacitor having a size (i.e., a capacitance) for storing a charge which is sufficient to ensure that data may be correctly written to and read out from the memory cell. Since scaling-down generally results in a shrinking of the horizontal dimensions of the memory cell, one possible way to provide a sufficiently-sized capacitor would be to increase the depth of the trench within which the capacitor is formed. In this way, the horizontal dimensions of capacitor may be scaled down while providing a capacitor of the same size or at least scaled down to a lesser degree. However, the high aspect ratios associated with such deep trenches create difficulties in the processes needed to fill the trenches. In short, to increase the size of trench capacitor 555 during scale-down, either the depth of the trench or the horizontal dimensions of the trench must be increased. Since increasing the depth suffers from processing problems as described above and since increasing the horizontal dimensions is contrary to scaling-down goal, it is difficult to increase the integration density of memory cells having the memory cell structure shown in Figures 1A and 1B for new generations memory devices.

One solution to this scaling-down problem is to overlap the transistor area and the deep trench area.

- Such a transistor over capacitor (TOC) arrangement is shown in U.S. Patent No. 4,649,625 to Lu, which is incorporated herein by reference. In this structure, the transfer gate is formed on epitaxial silicon which has been laterally grown over an insulator formed on the deep trench. Such laterally grown epitaxial silicon often suffers from defects which can adversely affect the operating characteristics of the transistor and thus of the memory cell itself.
- It would be desirable to provide semiconductor memory devices and methods of manufacturing the same which overcome these and other problems.

SUMMARY OF THE INVENTION

この発明の第1の形態による半導体記憶装置は、半導体基板と、この半導体基板上に形成された第1導電型の第1半導体領域と、この第1半導体領域上に形成され、前記第1導電型とは反対導電型である第2導電型の第2半導体領域と、トレンチを有するトレンチキャバシタであつて、前記トレンチは前記第1半導体領域及び前記第2半導体領域を通過し、前記トレンチキャバシタの上部が前記第2半導体領域の上表面には到達しないように形成され、前記トレンチ内には導電体トレンチフィルが形成されるトレンチキャバシタと、それぞれが前記第2半導体領域上に形成された一対のゲート電極であり、それぞれが前記トレンチキャバシタの上方に位置している一対のゲート電極と、前記一対のゲート電極のそれぞれを覆うように形成された一対の絶縁層と、前記一対の絶縁層のそれぞれに自己整合するように前記一対の絶縁層相互間に形成された導電層であり、この導電層の先端は前記第2半導体領域とは絶縁された状態で前記第2半導体領域の内部に達しており、かつ前記導電層は前記トレンチキャバシタの前記導電体トレンチフィルと電気的に接続されている導電層と、前記導電層を中心にして互いに対向するように配置され、それぞれが前記導電層と直接に接触する。前記第2半導体領域内に形成された第1導電型の一対の第3半導体領域であつて、この一対の第3半導体領域のそれぞれは前記一対のゲート電極のそれぞれを有するトランジスタのソース、ドレインのいずれか一方を構成し、前記一対の第3半導体領域のそれぞれは実質的に一様な深さで形成されている一対の第3半導体領域とを有することを特徴とする。

この発明の第2の形態による半導体記憶装置は、半導体基板と、この半導体基板に一定ピッチで配列形成され複数のトレンチキャバシタと、これらのトレンチキャバシタが形成された半導体基板上に形成された半導体層と、この半導

体層に埋め込み形成されて、隣接する二つのトレンチキャバシタにまたがる複数の能動素子領域を区画する素子分離絶縁膜と、前記各能動素子領域に、ソース、ドレイン拡散層の一方を共有し他方が隣接する二つのトレンチキャバシタの領域上に位置するように2個ずつ形成されて、ゲートが一方向に連続するワード線に接続された複数のトランジスタと、前記各トランジスタの前記ソース、ドレイン拡散層の他方を対応する前記トレンチキャバシタのキャバシタノード層に接続するコンタクト層と、前記ワード線と交差して配設されて前記トランジスタのソース、ドレイン拡散層の一方に接続されたビット線とを有することを特徴とする。

この発明において、トレンチキャバシタは具体的には、(a) 最小加工寸法をFとして一辺が2Fの略正方形であり、その正方形の対角線の方向を前記ワード線とビット線の直交二方向に一致させ、その正方形の直交する二辺の方向にスペースが1F以下の一定ピッチで配列されるか、或いは(b) 最小加工寸法をFとして一辺が2Fの略正方形であり、その正方形の辺の方向を前記ワード線とビット線の直交二方向に一致させ、ビット線方向にスペースが2F以上の一定ピッチで且つ、隣接するビット線では順次1/2ピッチずつずれた状態に配列されている。

(a), (b) いずれのトレンチキャバシタ配列の場合も、能動素子領域は、ビット線方向に一定ピッチで且つ隣接するビット線で順次1/4ピッチずつずれた状態に配列される。

この発明において、トランジスタの拡散層をトレンチキャバシタのキャバシタノード層に接続するためにコンタクト層が半導体層に埋め込まれるが、その具体的なコンタクトの態様には、次のような手法が用いられる。

(1) コンタクト層を、トランジスタ形成後に、トランジスタ拡散層を貫通してキャバシタノード層に達するように埋め込み形成する。

(2) 能動素子領域を形成する半導体層が第1及び第2のエピタキシャル成長層により構成する。そして、コンタクト層は、第2のエピタキシャル成長層の形成前に第1のエピタキシャル成長層に前記キャバシタノード層に達するように埋め込み形成する。トランジスタ拡散層は第2のエピタキシャル成長層形成後に形成して、その底面がコンタクト層の上面に接続されるようにする。

(3) コンタクト層を、トランジスタ形成前に半導体層にキャバシタノード層に達するように埋め込み形成し、トランジスタ拡散層が、コンタクト層の上部側方に形成された埋め込み拡散層を介してコンタクト層に接続されるようにする。

(4) コンタクト層を、トランジスタ形成前に半導体層にキャバシタノード層に達するように埋め込み形成し、トランジスタ拡散層は、その表面に形成された接続導体を介してコンタクト層の上面に接続されるようにする。

上記第2の形態の発明において、トレンチキャバシタは具体的に、トレンチ面から基板に拡散形成された半導体基板と逆導電型層からなる埋め込みプレートを有する。この埋め込みプレートの上端が半導体基板の表面位置より下になるように形成した場合には、トレンチキャバシタの上部に寄生トランジスタ等の動作を防止するためのカラー絶縁膜を形成することが必要になる。従ってまた、キャバシタコンタクト層も2段階に埋め込むことが必要になる。

これに対して、埋め込みプレートを半導体基板の表面まで形成する構造としてもよい。この場合には、トレンチキャバシタは、トレンチ内壁全体にキャバシタ絶縁膜を形成し、1ステップでコンタクト層を埋め込んだ簡単な構造とことができる。これにより、プロセスの簡略化が図られ、またトレンチキャバシタの実質面積が大きくなつて、後のコンタクト孔形成の際の合わせズレに対する余裕

が大きくなる。

また上述した(4)の表面ストラップ方式を採用する場合、キャパシタノード層上に埋め込まれるコンタクト層と、この上に形成されるトレンジスタ拡散層との間には一部重なる状態で一定の位置ズレを与えることが必要である。そのためには、例えば、能動素子領域をその中心がトレンチキャパシタの中心を通るようにレイアウトする場合には、コンタクト層はトレンチキャパシタの中心からワード線方向にずれた位置に形成する。或いは、②コンタクト層をトレンチキャパシタの中心に配置する場合に、能動素子領域がその中心がトレンチキャパシタの中心からワード線方向にずれた状態で配設する。

またこの発明において、トレンチキャパシタはその上に半導体層をエピタキシャル成長させる際にキャップ絶縁膜で覆われる。このため、トレンチキャパシタ領域上には多結晶半導体層が成長する。従って、能動能動素子領域にトランジスタ形成に先立ってウェルを形成する場合に、ウェルの境界が多結晶半導体層に接しない状態とすることが好ましい。具体的に、ウェルとトレンチキャパシタの埋め込みプレートの間で形成されるpn接合面が、多結晶層領域より上に形成されるようにすることで、接合リーケを低減することができる。

この発明において、半導体層は、キャパシタが形成された半導体基板に貼り合わせられた別の半導体基板のバルク半導体層と、このバルク半導体層に形成されたエピタキシャル成長層とから構成することもできる。この場合、トランジスタ拡散層をキャパシタノード層に接続するコンタクト層は、エピタキシャル成長層の形成前にバルク半導体層にキャパシタノード層に達するように埋め込み形成される。そして、ソース、ドレイン拡散層はエピタキシャル成長層形成後に形成されて、その底面がコンタクト層の上面に接続されるようになる。

また基板貼り合わせ技術を用いる場合に、好ましくは基板接合面には基板分離用絶縁膜を介在させる。そして、素子分離絶縁膜を、ビット線方向の素子分離領域に基板分離用絶縁膜に達する深さに埋め込み形成された第1の素子分離絶縁膜と、この第1の素子分離絶縁膜と一部重なりビット線方向とワード線方向の素子分離領域に第2の素子分離絶縁膜より浅く埋め込み形成された第2の素子分離絶縁膜とから構成する。

この発明の第3の形態による半導体装置は、半導体基板と、この半導体基板に能動素子領域を区画するために埋め込み形成された、第1の絶縁膜とこれより浅い第2の絶縁膜とからなる素子分離絶縁膜と、この素子分離絶縁膜により区画された前記能動素子領域に形成された素子とを有することを特徴とする。

この発明の第4の形態による半導体記憶装置の製造方法は、半導体基板に、キャパシタノード層がキャップ絶縁膜で覆われた状態で且つそのキャップ絶縁膜表面が前記半導体基板の表面より下に位置するように、複数のトレンチキャパシタを一定ピッチで配列形成する工程と、前記トレンチキャパシタが形成された半導体基板上に半導体層をエピタキシャル成長させる工程と、前記半導体層に素子分離絶縁膜を形成することにより、各能動素子領域が隣接する二つのトレンチキャパシタにまたがるように複数の能動素子領域を区画する工程と、前記各能動素子領域に二つずつのトランジスタをそのソース、ドレイン拡散層の一方を共有し、他方が前記トレンチキャパシタ上に位置するように、且つゲート電極が一方に連続するワード線となるように形成する工程と、前記ゲート電極の間に前記ソース、ドレイン拡散層の他方を貫通して前記キャパシタノード層に達するコンタクト層を埋め込む工程と、前記ソース、ドレイン拡散層の一方に接続されて前記ワード線と交差するようにビット線を形成する工程とを有することを特

徴とする。

この発明の第5の形態による半導体記憶装置の製造方法は、半導体基板に、キャパシタノード層がキャップ絶縁膜で覆われた状態で且つそのキャップ絶縁膜表面が前記半導体基板の表面より下に位置するように、複数のトレンチキャパシタを一定ピッチで配列形成する工程と、前記トレンチキャパシタが形成された半導体基板上に第1の半導体層をエピタキシャル成長させる工程と、前記第1の半導体層に前記キャパシタノード層に達するコンタクト層を埋め込む工程と、前記コンタクト層が埋め込まれた第1の半導体層上に第2の半導体層をエピタキシャル成長させる工程と、前記第2の半導体層に素子分離絶縁膜を形成することにより、各能動素子領域が隣接する二つのトレンチキャパシタにまたがるよう複数の能動素子領域を区画する工程と、前記各能動素子領域に二つずつのトランジスタをそのソース、ドレイン拡散層の一方を共有し、他方が前記コンタクト層の上面に接続されるように、且つゲート電極が一方に向連続するワード線となるように形成する工程と、前記ソース、ドレイン拡散層の一方に接続されて前記ワード線と交差するようにビット線を形成する工程とを有することを特徴とする。

この発明の第6の形態による半導体記憶装置の製造方法は、半導体基板に、キャパシタノード層がキャップ絶縁膜で覆われた状態で且つそのキャップ絶縁膜表面が前記半導体基板の表面より下に位置するように、複数のトレンチキャパシタを一定ピッチで配列形成する工程と、前記トレンチキャパシタが形成された半導体基板上に半導体層をエピタキシャル成長させる工程と、前記半導体層に前記トレンチキャパシタのキャパシタノード層に達するコンタクト層をその上端部が前記半導体層に形成される不純物拡散層に接続された状態に埋め込み形成する工程と、前記半導体層に素子分離絶縁膜を形成することにより、各能動素子領域が隣接する二つのトレンチキャパシタにまたがるよう複数の能動素子領域を区画する工程と、前記各能動素子領域に二つずつのトランジスタをそのソース、ドレイン拡散層の一方を共有し、他方が前記不純物拡散層を介して前記コンタクト層に接続されるように、且つゲート電極が一方に向連続するワード線となるように形成する工程と、前記ソース、ドレイン拡散層の一方に接続されて前記ワード線と交差するようにビット線を形成する工程とを有することを特徴とする。

この発明の第7の形態による半導体記憶装置の製造方法は、半導体基板に、キャパシタノード層がキャップ絶縁膜で覆われた状態で且つそのキャップ絶縁膜表面が前記半導体基板の表面より下に位置するように、複数のトレンチキャパシタを一定ピッチで配列形成する工程と、前記トレンチキャパシタが形成された半導体基板上に半導体層をエピタキシャル成長させる工程と、前記半導体層に前記トレンチキャパシタのキャパシタノード層に達するコンタクト層を埋め込み形成する工程と、前記半導体層に素子分離絶縁膜を形成することにより、各能動素子領域が隣接する二つのトレンチキャパシタにまたがるよう複数の能動素子領域を区画する工程と、前記各能動素子領域に二つずつのトランジスタをそのソース、ドレイン拡散層の一方を共有し、他方が前記トレンチキャパシタ領域上に位置するように、且つゲート電極が一方に向連続するワード線となるように形成する工程と、前記ソース、ドレイン拡散層の他方を対応する前記コンタクト層に接続するための表面接続導体を前記ワード線に自己整合された状態に形成する工程と、前記ソース、ドレイン拡散層の一方に接続されて前記ワード線と交差するようにビット線を形成する工程とを有することを特徴とする。

この発明の第8の形態による半導体記憶装置の製造方法は、半導体基板に、キ

ヤパシタノード層がキャップ絶縁膜で覆われた状態で複数のトレンチキャパシタを一定ピッチで配列形成する工程と、前記トレンチキャパシタが形成された半導体基板上に基板分離用絶縁膜を介して別の半導体基板を貼り合わせることにより第1の半導体層を形成する工程と、前記第1の半導体層に前記キャパシタノード層に達するコンタクト層を埋め込む工程と、前記コンタクト層が埋め込まれた第1の半導体層上に第2の半導体層をエピタキシャル成長させる工程と、前記第1及び第2の半導体層に素子分離絶縁膜を形成することにより、各能動素子領域が隣接する二つのトレンチキャパシタにまたがるように複数の能動素子領域を区画する工程と、前記各能動素子領域に二つずつのトランジスタをそのソース、ドレイン拡散層の一方を共有し、他方が前記コンタクト層の上面に接続されるように、且つゲート電極が一方向に連続するワード線となるように形成する工程と、前記ソース、ドレイン拡散層の一方に接続されて前記ワード線と交差するようにピット線を形成する工程とを有することを特徴とする。

この発明によると、トレンチキャパシタが埋め込まれた基板上に半導体層を形成してトランジスタを形成することにより、トレンチキャパシタを最密に配置してその占有面積を極大化することができる。またこれにより、トレンチキャパシタ加工の際のアスペクト比を下げ、更にキャパシタ面積を大きくしてトランジスタとの接続部の合わせずれに対する耐性を大きいものとすることができる。

These and other features and advantages of the present invention will be better understood from a reading of the following detailed description in conjunction with the accompanying drawings.

BRIEF DESCRIPTION OF THE SEVERAL VIEWS OF THE DRAWING
Figures 1A and 1B are a cross-sectional view and a top-down view, respectively, of a dynamic random access memory cell having a MINT architecture.

Figures 2A and 2B are used to illustrate various problems associated with the memory cell structure shown in Figures 1A and 1B.

Figure 3 is a top-down view of a semiconductor memory device in accordance with a first embodiment of the present invention.

Figures 4A and 4B are cross-sectional views taken along lines 4A-4A' and 4B-4B' of Figure 3, respectively.

Figures 5A-5J are cross-sectional views corresponding to Figure 4A which illustrate a method of manufacturing the semiconductor memory device of Figures 3, 4A, and 4B.

5 Figure 6 is a top-down view of a semiconductor memory device in accordance with a second embodiment of the present invention.

Figure 7 is a cross-sectional view taken along line 7-7' of Figure 6.

10 Figure 8 illustrates a wafer-bonding technique which may be used in the process of forming the semiconductor memory device of Figure 6.

15 Figures 9A and 9B are storage node cross-sections corresponding to the views of Figures 4A and 4B for a semiconductor memory device in accordance with a third embodiment of the present invention.

Figure 10 is a top-down view of a semiconductor memory device in accordance with a fourth embodiment of the present invention.

20 Figure 11 is a cross-sectional view taken along line 11-11' of Figure 10.

Figure 12 is a cross-sectional view taken along line 12-12' of Figure 10.

25 Figures 13A-13J are cross-sectional views which illustrate a method of manufacturing the semiconductor memory device of Figures 10.

Figures 14A-14D are cross-sectional views which

illustrate a method of manufacturing a semiconductor memory device in accordance with a fifth embodiment of the present invention.

Figure 15 is a top-down view of a semiconductor memory device in accordance with a sixth embodiment of the present invention.

Figures 16A-16E are cross-sectional views which illustrate a method of manufacturing a semiconductor memory device in accordance with a seventh embodiment of the present invention.

Figure 17 is a cross-sectional view of a semiconductor memory device in accordance with an eighth embodiment of the present invention.

Figure 18 is a top-down view of a semiconductor memory device in accordance with a ninth embodiment of the present invention.

Figures 19A-19F are cross-sectional views which illustrate a method of manufacturing the semiconductor memory device of Figure 18.

Figure 20 is a top-down view of a semiconductor memory device in accordance with a tenth embodiment of the present invention.

Figure 21 is a cross-sectional view taken along line 21-21' of Figure 20.

Figure 22 is a cross-sectional view taken along line 22-22' of Figure 20.

Figures 23A-23H are cross-sectional views which

illustrate a method of manufacturing the semiconductor memory device of Figures 20, 21, and 22.

Figure 24 is a top-down view of a semiconductor memory device in accordance with an eleventh embodiment
5 of the present invention.

Figure 25 is a top-down view of a semiconductor memory device in accordance with a twelfth embodiment of the present invention.

Figures 26A-26D are cross-sectional views which
10 illustrate a method of manufacturing a semiconductor memory device in accordance with a thirteenth embodiment of the present invention.

Figure 27 is a cross-sectional view which
15 illustrate a semiconductor memory device in accordance with a fourteenth embodiment of the present invention.

Figures 28A-28F are cross-sectional views which illustrate a method of manufacturing the semiconductor memory device of Figure 27.

Figure 29 is a top-down view of a semiconductor memory device in accordance with a fifteenth embodiment
20 of the present invention.

Figure 30 is a cross-sectional view taken along line 30-30' of Figure 29.

Figure 31 is another top-down view of the
25 semiconductor memory device in accordance with the fifteenth embodiment of the present invention.

Figure 32 is a cross-sectional view which

00000000000000000000000000000000

illustrate the semiconductor memory device of Figure 29.

Figure 33 is a cross-sectional view which
illustrate the semiconductor memory device of Figure 29.

5

DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

Figure 3 is a top-down view of a semiconductor
memory device 100 in accordance with a first embodiment
of the present invention. Figure 4A is a cross-
sectional view taken along line 4A-4A' of Figure 3 and
10 Figure 4B is a cross-sectional view taken along line
4B-4B' of Figure 3. The cross-sectional view of Figure
4A is extended to a support circuit region of the
semiconductor memory device which is not shown in
Figure 3. Generally, circuits such as decoders, sense
15 amplifiers, and the like are formed in the support
circuit region. With reference to Figure 3, memory
device 100 includes bit lines 102 formed to extend in a
first direction (i.e., horizontally in Figure 3) and
word lines 136 formed to extend in a second direction
20 (i.e., vertically in Figure 3). The portions of the
word lines which extend over the channel regions of the
transfer transistors constitute the gate electrodes of
the transfer transistors. Bit line contacts 106 are
arranged at a one-quarter pitch. That is, the bit line
25 contacts for every fourth bit line are vertically
aligned. A plurality of active areas AA are defined by
shallow trench isolation (STI) structures 108 (see

20250000000000000000000000000000

Figures 4A and 4B). Active areas AA have a width extending in the word line direction and a length extending in the bit-line direction. The trench capacitors (storage nodes) of the memory cells are
5 formed in deep trenches 110. Deep trenches 110 have a width extending in the bit line direction and a length extending in the word line direction. Storage node contacts 112 are located between adjacent ones of the word lines and provide an electrical connection between
10 the trench capacitors and the transfer gates.

As can be seen with reference to Figures 4A and 4B, an N-type diffusion region 116 and a P-type well region 118 are provided in the memory cell array region of a P-type silicon substrate 114. P-type well region 118
15 is also provided in the support circuit region of the silicon substrate 114. N-type diffusion region 116 has an impurity concentration (e.g., more than $1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ at the peak) which is higher than the impurity concentration of the silicon substrate 114 and serves as a buried plate electrode for the memory cells
20 of the memory device 100. P-type well region 118 has an impurity concentration of approximately $1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ to $1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$. The trench capacitors include a first trench fill 120 which is insulated from
25 the buried plate electrode 116 by a storage node insulating layer 122. Storage node insulating film 122 may, for example, be a nitride/oxide (NO) film includ-

00966365 091200

ing a layer of silicon nitride (Si_3N_4) and a layer of silicon dioxide (SiO_2). A second trench fill 124 is insulated from P-well 118 and buried plate electrode 116 by a collar oxide film 126. Collar oxide film 126
5 may, for example, be a silicon dioxide (SiO_2) film. A silicon dioxide (SiO_2) layer 128 is formed at the upper portion of deep trenches 110 and is spaced from P-well region 118, from collar oxide film 126, and from second trench fill 124 by a silicon dioxide
10 (SiO_2)/silicon nitride (Si_3N_4) liner layer 130. Each transfer gate includes spaced apart N-type source and drain regions 132 and 134. As shown in Figure 4A, adjacent transfer transistors formed in a given active area have a common N-type drain region 134. Each
15 transfer transistor further includes a gate electrode 136 which is insulatively spaced from a channel region between the N-type source and drain regions 132 and 134 by a gate insulating layer 138 of, for example, silicon dioxide (SiO_2). Gate electrode 136 is a polycide gate electrode including a polysilicon layer 136a and a silicide layer 136b (e.g., tungsten silicide) formed on the polysilicon layer, and a cap nitride layer (not shown) formed on silicide layer 136b. A conformal barrier layer 140 of, for example, silicon nitride
20 (Si_3N_4), is formed on gate insulating layer 138 and the gate electrodes 136 and a BPSG layer 142 fills in the depressions in the barrier layer 140. Self-aligned
25

00250000000000000000000000000000

storage node contacts (strap layers) 112 of polysilicon, for example, electrically connect the trench capacitors (via an opening formed in insulating layer 128 and liner layer 130) to the source regions 132 of the transfer transistors. As can be seen in Figure 4A, storage node contacts 112 are formed between adjacent gate electrodes 136 and are insulated from P-well region 118 by an insulating layer 146. Bit line contacts 106 of, for example, polysilicon, are formed to contact the common drain region between adjacent transfer transistors. A first interlayer insulating film 148 of, for example, P-TEOS, is formed on the upper surfaces of barrier layer 140, BPSG layer 142, storage node contacts 112, and bit line contacts 106. Bit lines 102 and contacts 103 are formed in the memory cell region by a dual damascene process in which vias 149 and trenches 150 are formed in insulating layer 148, a metal such as tungsten is deposited on insulating layer 148 and in the vias and the trenches, and the deposited metal is planarized so as to be substantially level with the upper surface of insulating layer 148 (see Figure 4B). Similarly, in the support circuit region, damascene and/or dual damascene processes may be utilized to form contacts 160, 161 to gates and diffusion regions and to form wiring 162. A second interlayer insulating film 152 of, for example, P-TEOS, is formed on first interlayer insulating film 148.

A metallization layer is formed on the second inter-layer insulating film 152 and is patterned to form wirings 156. As shown in Figure 4A, in the support circuit region, a contact 164 formed in an opening 163 in second interlayer insulating film 152 connects one of the wirings 156 to wiring 162.

A method for manufacturing the above-described semiconductor memory device will be described with reference to Figures 5A-5J. Turning to Figure 5A, the surface of a P-type silicon substrate 114 is thermally oxidized to form a first pad oxide layer 202 of silicon dioxide (SiO_2) having a thickness of about 10 nanometers. The thermal oxidation is performed at about 900°C in an atmosphere of dry O_2 . Substrate 114 may be a silicon wafer or an epitaxial layer formed on a silicon wafer. A pad silicon nitride (Si_3N_4) layer 204 having a thickness of about 100 nanometers is then formed on pad oxide layer 202 by, for example, chemical vapor deposition (CVD). A second pad oxide layer (not shown in Figure 5A) having a thickness of approximately 400 nanometers is then formed by the evaporation of TEOS ($\text{Si}(\text{OC}_2\text{H}_5)_4$). Deep trenches 110 each having a depth of approximately 4.9 micrometers, a width (in the bit line direction) of approximately 0.20 micrometers, and a length (in the word line direction) of approximately 0.60 micrometers are formed in silicon substrate 114 in the memory cell region using a

002160-06009500

00000000000000000000000000000000
5 patterned resist (not shown) and an etching process such as reactive ion etching (RIE). Deep trenches 110 have an aspect ratio (width/depth) of 25. An N-type diffusion region 116 is then formed in substrate 114 in
10 the memory cell region by implanting impurities and AsG diffusion. The implant may be performed using a dose of $1 \times 10^{13} \text{ cm}^{-2}$ of phosphorus and an acceleration voltage of 1.5 MeV. The ASG diffusion may be performed by the deposition of an ASG layer and an ASG layer recess process down to a level which is deeper by the diffusion length than the intended top of region 116, followed by annealing at about 1050°C for 30 minutes to form diffusion region 116. The buried N-type well may be formed by other methods, e.g., P-well implantation
15 into an N-type semiconductor substrate or by epitaxy, and the invention is not limited in this respect.

An insulating layer 122 such as a nitride-oxide (NO) layer or an oxide-nitride layer is then formed on the entire surface. For example, insulating layer 122 may include a silicon nitride (Si_3N_4) layer of about 6 nanometers deposited using a low pressure chemical vapor deposition method and a silicon dioxide (SiO_2) layer of about 2 nanometers formed by oxidation of the silicon nitride layer at 900°C in an atmosphere of wet O_2 . The target thickness of the insulating layer 122 (T_{effective}) is about 4-5 nm silicon dioxide equivalent. After insulating layer 122 is formed, first conductive

regions are formed by filling deep trenches 110 with an impurity-doped first conductive material such as N⁺-type polycrystalline silicon. The doping concentration of the first conductive material is greater than 3 × 5 10¹⁷ cm⁻³. The filling step may be carried out using chemical vapor deposition of silane or disilane, for example. The N⁺-type polycrystalline silicon is then etched back to a first level within deep trenches 110 using an isotropic etch process such as reactive ion etching to form first trench fills 120. Specifically, 10 the N⁺-type polycrystalline silicon is etched back to a level which is about 1 micrometer (μ m) below the surface of the semiconductor substrate. The second pad oxide layer is removed before the etch-back of the 15 first fill in the deep trench and after a blanket etch back of the deposited polycrystalline silicon to the top surface of the second pad oxide layer by RIE. Insulating layer 122 is then etched by wet etching to remain at the lower portion of the trench so as to form 20 a storage node insulating layer which insulates the first trench fill from the semiconductor substrate. A collar oxide film 126 is then formed on the sidewalls of the portions of deep trenches 110 opened by the etching back of the N⁺-type polycrystalline silicon 25 using low pressure chemical vapor deposition (LPCVD) or plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD) TEOS over the entire surface followed by an etch back using

reactive ion etching.

Second conductive regions are then formed by filling in the remainder of deep trenches 110 with a second conductive material. The second conductive material may be, for example, N⁺-type polycrystalline silicon or undoped polycrystalline silicon and may be formed by chemical vapor deposition (CVD). The second conductive material is etched back by reactive ion etching or some other chemical dry etching process to a level which is about 0.1 micrometer (μm) below the surface of the semiconductor substrate. The collar oxide 126 is etched by a wet etch and remains as shown in Figure 5A. Next, a very thin oxide layer having a thickness of approximately 5 nanometers and a silicon nitride (Si_3N_4) layer having a thickness of approximately 5 nanometers are formed on the upper surface of pad silicon nitride layer 204, on the sidewalls of deep trenches 110, and on the exposed portions of collar oxide film 126 and second trench fill 124. The thin oxide layer is formed, for example, by a rapid thermal oxidation at 1050°C and the silicon nitride layer is formed, for example, by CVD. For purposes of clarity, the thin oxide layer and the silicon nitride layer are shown as a single liner layer 130 in Figure 5A. A TEOS layer 128 is then formed by LPCVD, for example, on the upper surface of layer 130 and to fill in deep trenches 110 as shown in Figure 5A.

TEOS layer 128 is then recessed by chemical
mechanical polishing and RIE to be substantially level
with the surface of substrate 114. Liner layer 130 is
then removed from the upper surface and the sidewall of
5 pad silicon nitride layer 204 and from the sidewall of
pad oxide layer 202, and pad silicon nitride layer 204
and pad oxide layer 202 are removed from the surface of
the substrate as shown in Figure 5B. The silicon
nitride is etched, for example, by H₃PO₄ and the
10 silicon oxide is etched, for example, by an HF solution.

An epitaxial silicon layer 208 having a thickness
of about 0.2 micrometers (μm) is then grown by a solid
phase epitaxial growth method on the surface of semi-
conductor substrate 114 in the memory cell region and
15 in the support circuit region as shown in Figure 5C.
The portion of the epitaxial layer 208 above silicon
substrate 114 in the memory cell region, on which the
transfer transistor will be formed as described below,
is high-quality single crystal silicon. The portion of
20 the epitaxial layer 208 above the trench structures in
the memory cell region is formed by horizontal
epitaxial growth and thus may have twin boundaries.
However, as will become evident, this portion of the
epitaxial layer will be removed during the steps for
25 forming the storage node contacts 112.

With reference to Figure 5D, a pad oxide layer 210
of silicon dioxide (SiO₂) and a pad nitride layer 212

00000000000000000000000000000000

of silicon nitride (Si_3N_4) are successively formed on the surface of epitaxial silicon layer 208. Pad oxide layer 210 may be formed by thermal oxidization (e.g., 5 900°C in an atmosphere of dry O_2) and may have a thickness of about 10 nanometers. Pad nitride layer 212 may be formed by chemical vapor deposition and may have a thickness of about 100 nanometers. Shallow trenches 214 are then formed in epitaxial layer 208 using a patterned resist (not shown) and an etching 10 process such as reactive ion etching (RIE). The dimensions of the shallow trenches are dependent upon feature size. For example, for a 1 Gbit DRAM, shallow trenches 214 may have a width of 0.15 micrometers (μm) and a depth of 0.15 micrometers (μm). An insulating 15 layer of, for example, TEOS, is then blanket deposited over the surface of pad nitride layer 212 and in shallow trenches 214. The insulating layer is then etched back using, for example, CMP and RIE, with pad nitride layer 212 serving as a stopper layer, whereby 20 shallow trench isolation structures 108 which define the active areas AA are formed.

With reference to Figure 5E, pad nitride layer 212 and pad oxide layer 210 are removed and a sacrificial oxide (not shown) having a thickness of about 6 25 nanometers (nm) is then formed by furnace oxidation or rapid thermal oxidation (RTO) on the surface of epitaxial layer 208. P-type well region 118 is formed

by implanting P-type impurities into the entire surface of the substrate. For example, boron is implanted at a dose of about $1 \times 10^{13} \text{ cm}^{-2}$ and acceleration voltages of 10 keV to 300 keV (a retrograde P-well is formed by several acceleration voltages). If desired, a step of implanting impurities into portions of the substrate which will constitute the channel regions of the transfer transistors in the memory cell region and other transistors in the support circuit region may be performed. This implanting of impurities into the channel regions permits a tailoring of the threshold voltage of the transistors. The sacrificial oxide layer is then removed and a gate insulating layer 138 is formed on the surface of the substrate. Gate insulating layer 138 has a thickness of about 6 nanometers (nm) and may be formed by thermal oxidation at a temperature of approximately 850°C. Alternatively, gate insulating layer 138 may be formed by chemical vapor deposition (CVD) and the invention is not limited in this respect. Gate electrodes 136 for the transfer transistors in the memory cell region and for transistors in the support circuit region are then formed by depositing a polysilicon layer which is doped with N⁺-type impurities, followed by a layer of metal silicide such as tungsten silicide (WSi). After the WSi deposition, a cap silicon nitride layer (not shown) having a thickness of about 15 nanometers (nm) is

formed on the WSi layer. The cap silicon nitride layer is provided so that a self-aligned contact may be formed while maintaining isolation between the gate electrodes 136 and bit line contacts 106 and storage node contacts 112. Then, using a patterned photoresist (not shown) and an etching process such as RIE, the cap silicon nitride layer, the silicide layer and the polysilicon layer are etched to form gate electrodes (word lines) 136 in the memory cell region and gate electrodes 136 in the support circuit region. Next, N-type impurities such as phosphorus or arsenic are ion-implanted using gate electrodes 136 as a mask to form N-type source regions 132 and drain regions 134 for the transfer transistors in the memory cell region and to form N-type source and drain regions for the N-channel transistors in the support circuit region. To form P-type source and drain regions for P-channel transistors in the support circuit region, BF₂ or B is implanted. Then, a barrier layer 140 of, for example, silicon nitride (Si₃N₄) having a thickness of approximately 30 nanometers (nm) is deposited by CVD. Next, an insulating layer 142 of BPSG, for example, is deposited on barrier layer 140. Insulating layer 142 is planarized by chemical mechanical polishing using barrier layer 140 as a stopper layer, resulting in the structure shown in Figure 5E.

With reference to Figure 5F, a photoresist (not

shown) is deposited. The photoresist is patterned and is used as a mask for selectively etching the portions of insulating layer 142 and barrier layer 140 above source regions 132 and drain regions 134 in the memory cell region. Specifically, using the photoresist as a mask, a selective etch is used to etch insulating layer 142, and then barrier silicon nitride layer 140 is etched by a silicon nitride etching process to open contact regions.

With reference to Figure 5G, a patterned photoresist 214 is formed for providing contacts to the storage nodes in deep trenches 110 in the memory cell region. Gate insulating layer 138, the silicon substrate, and TEOS layer 128 are etched by an etching process such as reactive ion etching using the patterned photoresist 214 and the gate electrodes 136, with the barrier layer 140 on the top and sidewalls thereof, as a mask to form storage node contact openings 216. The silicon nitride layer which is part of liner layer 130 is then etched. Since gate electrodes 136 are part of the etching mask, the etching process is a self-aligned etching process. Specifically, gate insulating layer 138 is etched by RIE (or by wet etching); the silicon substrate is etched by RIE; and TEOS layer 128 is etched by RIE. The etching of the silicon nitride which is part of liner 130 is accomplished by using wet etching (e.g.

H₃PO₄) or dry etching.

With reference to Figure 5H, the patterned photoresist 214 is removed and the gate insulating film 138 above drain region 134 is etched to form contact openings 218. An insulating layer 146 of, for example, silicon dioxide having a thickness of about 10 nanometers is deposited over the entire surface and then etched using RIE to expose second trench fill 124. Any remaining portion of the oxide layer of liner 130 on the surface of second trench fill 124 is also etched at this time. Next, a photoresist (not shown) is deposited and recessed to a predetermined depth within storage node contact openings 216. Using the recessed resist as a mask, the unmasked portions of insulating layer 146 are removed by, for example, wet etching so that the upper portion of insulating layer 146 is about 50 nanometers (nm) below the surface of the semiconductor substrate. The recessed resist is then removed and an in-situ phosphorus-doped polysilicon layer is deposited by, for example, chemical vapor deposition, to fill in storage node contact openings 216 and bit line contact openings 218, thereby forming storage node contacts 112 and bit line contacts 106. It will be apparent that insulating layer 146 must be etched-back to a level which permits connection between storage node contact 112 and source region 132, but no connection between storage node contact 112 and

P-well 118. The bit line contacts 106 and storage node contacts 112 are then planarized by chemical mechanical polishing to be substantially level with the upper surface of barrier layer 140 as shown in Figure 5H.

5 With reference to Figure 5I, a first interlayer insulating film 148 of, for example, P-TEOS is then deposited. Bit lines 102 and contacts 103 to bit line contacts 106 in the memory cell region and wiring 162 and contacts 160 and 161 to the transistors and
10 diffusion regions in the support circuit region may be formed by a so-called dual damascene process.

A "damascene" process refers to a process in which a trench or via is formed and then filled in with a conducting material, followed by planarization. A dual
15 damascene process involves the simultaneous fabrication of a conductive via and a conductive wiring. Such a process reduces the number of process steps and eliminates an interface between the conductive via and the conductive wiring. In the present method, vias and
trenches for the contacts 103 and bit lines 102 in the
20 memory cell region are formed in P-TEOS layer 148 by conventional photolithography and RIE processing. Vias and trenches are similarly formed for the contacts 160, 161 and wiring 162 in the support circuit region. Then,
25 tungsten is deposited by CVD. The tungsten is then planarized by chemical mechanical polishing down to the top of the P-TEOS layer 148, i.e., P-TEOS layer 148

acts as a stopper layer for the CMP process. An adhesion/barrier layer such as titanium nitride may be formed, for example, by sputtering prior to the deposition of the tungsten. A second interlayer insulating film 152 of, for example, P-TEOS is then deposited and an opening 163 is formed therein to expose wiring 162 in the support circuit region.

5 insulating film 152 of, for example, P-TEOS is then deposited and an opening 163 is formed therein to expose wiring 162 in the support circuit region.

A contact 164 to wiring 162 is formed in opening 163 using a damascene process in which opening 163 is

10 formed by conventional lithography and etching processing, followed by the deposition and planarization of a conductive material such as tungsten.

A conductive layer is then deposited and patterned to form wirings 156 as shown in Figure 5J.

15 The memory device shown in Figures 3, 4A, and 4B and manufactured in accordance with the method explained with reference to Figures 5A-5J includes highly integrated memory cells having capacitors for storing a charge which is sufficient to ensure that data may be correctly written to and read out from the memory cell. This memory cell has a compact cell size of $8F^2$, where F is a feature size and the cell size is $2F \times 4F$. In addition, the memory cell overcomes many of the disadvantages associated with the MINT architecture.

20 For example, as can be seen with reference to Figures 5G and 5H, the steps for forming the storage node contact (strap) do not affect the transfer tran-

002607-000000000000

sistor. In addition, there is no discontinuity of the cell array junction to the strap junction caused by ion implantation shadowing due to a passing word line.

5 Still further, there is no volume expansion of the active area oxide and the collar oxide at the deep trench-active area intersection. This serves to reduce the incidence of defects and stress. Yet further, there is no deep trench-shallow trench isolation intersection. Thus, the process for forming the shallow

10 trench isolation structures does not adversely affect the deep trench capacitor. The process provides for long and high temperature stress relief anneal when the gate conductors are formed since the strap is formed after the gate conductor process. In addition, the

15 transfer transistor is formed on a high-quality silicon layer and therefore possesses good operating characteristics. Specifically, with reference to Figure 5G, it can be seen that the storage node contact is formed by etching the epitaxial silicon above the deep

20 trenches and that the transfer transistor is formed in the high-quality epitaxial silicon formed above the substrate 114. Thus, the memory device of the present invention offers the possibility of being applied to 1 GBit DRAMs and beyond. Still further, the trench

25 capacitor and the transfer transistor are connected using a self-aligned process. Specifically, the gate electrode functions as part of a mask for the etching

process for forming the opening for the connecting strap. By using such a self-aligned process, misalignment errors can be avoided and the strap between trench capacitor and the transfer transistor
5 can be accurately formed. In addition, as can be seen with reference to Tables 1 & 2 below, a large deep trench having horizontal dimensions of approximately $3F \times F = 3F^2$ is available, resulting in a shallower deep trench depth than the MINT cell of Figures 1A and
10 1B. This simplifies the deep trench processing and reduces manufacturing costs. Still further, a well-controlled shallow trench isolation process is realized since the STI depth is shallower than in the MINT cell and can be more easily filled, active area patterning
15 is easier than in a MINT cell, and STI height control is better than in a MINT cell due to enhanced uniformity of the pad silicon nitride since the pad silicon nitride is not affected by the deep trench processes in the invention.

20 Figure 6 is a top-down view of a memory device in accordance with a second embodiment of the present invention. Figure 7 is a cross-sectional view taken along line 7-7' of Figure 6. The portions of the memory device of Figures 6 and 7 which are the same as
25 in the first embodiment are denoted by the same reference numbers. With reference to Figure 6, memory device 300 includes bit lines 102 formed to extend in a

first direction (i.e., horizontally in Figure 6) and word lines 136 formed to extend in a second direction (i.e., vertically in Figure 6). Bit line contacts 106 are arranged at a one-half pitch. That is, the bit
5 line contacts for every other bit line are vertically aligned. A plurality of active areas AA are defined by shallow trench isolation (STI) structures 108 (see Figure 7). Active areas AA have a width extending in the word line direction and a length extending in the bit-line direction. The trench capacitors (storage nodes) of the memory cells are formed in deep trenches
10 110'. Deep trenches 110' have a width extending in the word line direction and a length extending in the bit line direction. Storage node contacts 112 are located between adjacent ones of the word lines and provide an electrical connection between the trench capacitors and
15 the transfer gates.

In the second embodiment, deep trenches 110' are oriented in a direction which is orthogonal to the
20 direction in which the deep trenches 110 are oriented in the first embodiment. Because of this, forming the semiconductor memory device of Figures 6 and 7 using the method described with respect to Figures 5A-5J will cause the transfer transistors to be formed in the portion of the epitaxial layer over the deep trench.
25 As noted above, this portion of the epitaxial layer may have defects which could adversely affect the operation

of the transfer transistors. In order to provide a high quality epitaxial layer in which to form the transfer transistors, the epitaxial layer may be subjected to a high temperature annealing process (e.g., 5 at a temperature of about 1100°C in an atmosphere of N₂). Alternatively, a laser or an electron beam anneal may be used. In still another alternative embodiment, a wafer bonding technique such as that shown in Figure 8 may be utilized. Specifically, a first silicon wafer 10 302 having the trench capacitors formed therein is bonded to a second silicon wafer 306 having shallow trench isolation regions 108 formed therein. Second silicon wafer 306 is then polished by, for example, chemical mechanical polishing (CMP) to provide a 15 silicon layer 308 having a thickness of, for example, about 0.15 micrometers (μm) for a 1 Gbit DRAM. The process steps of Figures 5E-5J may then be carried out to form the semiconductor memory device of Figures 6 and 7. In this way, the problems associated with low 20 quality epitaxial films grown over the deep trenches can be avoided.

Figure 9A and 9B show a cross-section of a memory cell in accordance with a third embodiment of the present invention. In the embodiment of Figures 9A and 25 9B, first trench fill 402 has a cylindrical shape. In this way, the depth of the trench in which the capacitor is formed can be decreased. A memory cell of

this embodiment can be formed by performing the steps as in the first embodiment for forming the deep trenches. After the deep trench etch, an oxide layer 422 having a thickness, for example, of 50 nanometers
5 (nm) is deposited and etched by reactive ion etching so as to remain on the deep trench sidewall. Then an N^+ type polycrystalline silicon layer is deposited and etched back to a level which is about 1 micrometer (μm) below the surface of the semiconductor substrate. Then,
10 a node dielectric film 424 is formed. Next, a second polysilicon layer is deposited and etched back to a level which is 0.1 higher than the first polysilicon layer 402. After this, the process is the same as the process for the first embodiment.

10

15

20

25

D1

TABLE 1

Cell Type	MINT	First Embodiment/ Second Embodiment	Third Embodiment
Design Rule, F	0.18 μm	0.18 μm	0.18 μm
Cell Size	$0.36 \times 0.72 \mu\text{m}^2$ $= 0.2592 \mu\text{m}^2$	$0.36 \times 0.72 \mu\text{m}^2$ $= 0.2592 \mu\text{m}^2$	$0.36 \times 0.72 \mu\text{m}^2$ $= 0.2592 \mu\text{m}^2$
Trench Size	$0.22 \times 0.36 \mu\text{m}^2$ $= 0.0792 \mu\text{m}^2$	$0.20 \times 0.60 \mu\text{m}^2$ $= 0.12 \mu\text{m}^2$	$0.20 \times 0.60 \mu\text{m}^2$ $= 0.12 \mu\text{m}^2$
Cs	30 fF	30 fF	30 fF
T_{ox} effective	4 nm	4 nm	4 nm
Total Trench Depth	7.0 μm	4.9 μm	3.0 μm
Aspect ratio of Trench	32	25	15

Table 1 provides a cell comparison for the first generation of 1 Gbit DRAM devices having a 0.18 micron design rule. As can be seen from the data set forth in Table 1, DRAM devices manufactured in accordance with the embodiments of the present invention provide the same capacitance as scaled down cells manufactured in

accordance with the MINT architecture shown in Figures 1A and 1B of this patent application, while at the same time providing trenches with smaller aspect ratios within which the capacitors are formed. Specifically, 5 1 Gbit memory cells in accordance with the first and second embodiments of the present invention have trench capacitors formed in trenches with aspect ratios which are 28% less than the aspect ratio of the trenches for 1 Gbit memory cells based on scaling down the current 10 MINT architecture. Memory cells in accordance with the third embodiment of the present invention have trench capacitors formed in trenches with aspect ratios which are more than 50% less than the aspect ratios of the trenches for the scaled down MINT architecture. As 15 noted above, the ability to achieve a high capacitance for trench capacitors formed in trenches with small aspect ratios provides for easier manufacturing.

00000000000000000000000000000000

5

10

15

20

25

TABLE 2

Cell Type	MIN _T	First Embodiment/ Third Embodiment	
		Second Embodiment	Third Embodiment
Design Rule, F	0.12 μm	0.12 μm	0.12 μm
Cell Size	$0.24 \times 0.48 \mu\text{m}^2$ = 0.1152 μm^2	$0.24 \times 0.48 \mu\text{m}^2$ = 0.1152 μm^2	$0.24 \times 0.48 \mu\text{m}^2$ = 0.1152 μm^2
Trench Size	$0.15 \times 0.26 \mu\text{m}^2$ = 0.039 μm^2	$0.14 \times 0.38 \mu\text{m}^2$ = 0.0532 μm^2	$0.14 \times 0.38 \mu\text{m}^2$ = 0.0532 μm^2
C _s	25 fF	25 fF	25 fF
T _{ox} effective	3 nm	3 nm	3 nm
Total Trench Depth	7.4 μm	5.5 μm	3.5 μm
Aspect ratio of Trench	49	39	25

Table 2 provides a cell comparison for the first generation of 4 Gbit DRAM devices having a 0.12 micron design rule. As can be seen from the data set forth in Table 2, DRAM devices manufactured in accordance with the embodiments of the present invention provide the same capacitance as scaled-down cells manufactured in

accordance with the MINT architecture shown in Figures 1A and 1B of this patent application, while at the same time providing trenches with smaller aspect ratios within which the capacitors are formed. Specifically,
5 4 Gbit memory cells in accordance with the first and second embodiments of the present invention have trench capacitors formed in trenches with aspect ratios which are about 25% less than the aspect ratio of the trenches for 4 Gbit memory cells based on scaling down
10 the current MINT architecture. Memory cells in accordance with the third embodiment of the present invention have trench capacitors formed in trenches with aspect ratios which are almost 50% less than the aspect ratios of the trenches for the scaled-down MINT
15 architecture. As noted above, the ability to achieve a high capacitance for trench capacitors formed in trenches with small aspect ratios provides for easier manufacturing.

20 次にこの発明の第4の実施例について説明する。
21 図10は、第4の実施例のDRAMレイアウトを示し、図11及び図12は図
22 10の断面を示している。この実施例では、シリコン基板1に、図10に破線で示すように、トレンチキャバシタ（以下、単にキャバシタという）2が正方形をなして一定ピッチで配列される。キャバシタ2の大きさは、最小加工寸法をFとして例えば $2F \times 2F$ であり、その対角線の方向がビット線BLとワード線WLの直交二方向（以下、ビット線BLの方向をx、ワード線WLの方向をyとする）に一致するように、且つx、y方向から 45° 傾斜した方向（即ち、キャバシタの直交する二辺の方向）に、スペースが1Fの一定ピッチでマトリクス配列されている。実際にはキャバシタ溝形成時、オーバーエッチングを行う等の加工条件により、スペースは1F以下になり得る。

23 キャバシタ2が形成された基板1上には、シリコン層3がエピタキシャル成長され、このシリコン層3にキャバシタ2に一部重なる状態でトランジスタ6が形成される。トランジスタ6が形成される能動素子領域5は、図10に太線で囲ん

だように、x 方向に隣接する二つのキャパシタ 2 の領域にまたがるように細長い島状をなして素子分離絶縁膜 4 により区画され、x 方向に 6 F の大きさで且つ、2 F のスペースをもって配列され、y 方向には順次 1 / 4 ピッチずつずれた状態で配列される。

ワード線 WL は、トランジスタ 6 のゲート電極 6 2 を y 方向に連続的に配設して形成される。ピット線 (BL) 7 は、ワード線 WL と直交して配設される。

ピット線 BL は、トランジスタ 6 のソース、ドレイン拡散層 6 3 のうち、一つの素子領域 4 に形成された隣接する二つのトランジスタの共通拡散層 6 3 に対して、キャパシタ・コンタクト層 8 を介して接続される。トランジスタの他方の拡散層 6 3 は、キャパシタ 2 の領域に位置して、キャパシタ 2 上に埋め込み形成されたコンタクト層 9 に接続される。コンタクト層 9 は後述するように、ワード線 WL の間に自己整合されて埋め込み形成される。

この実施例の具体的なDRAM 製造工程を、図 1 1 の断面に対応する断面を用いて、図 1 3 A～図 1 3 J を参照して説明する。

シリコン基板 1（少なくともそのメモリセルアレイ領域が p 型である）にまず、5 nm 程度のパッド酸化膜（シリコン酸化膜）1 1 0 1 を熱酸化により形成し、その上に 200 nm 程度のパッド窒化膜（シリコン窒化膜）1 1 0 2 を堆積する。

更にその上に TEOS 酸化膜（図示せず）を堆積する。そして、リソグラフィにより TEOS 酸化膜上に、図 1 0 に示すトレチ 2 のレジストパターンを形成し、TEOS 酸化膜、パッド窒化膜 1 1 0 2、パッド酸化膜 1 1 0 1 を RIE（Reactive Ion Etching）によりエッチングする。

レジスト剥離後、パッド窒化膜 1 1 0 2 とパッド酸化膜 1 1 0 1 をマスクとして、シリコン基板 1 を RIE によりエッチングし、キャパシタ用トレチ 2 1 を形成する。トレチ 2 1 の形成後、その内部を軽く酸化し、ASG の堆積と熱処理による固相拡散、または As 気相拡散により、n 型埋め込みブレート 2 4 を形成する。トレチ 2 上部には、n 型にならずに p 型層が残るようとする。この埋め込みブレート 2 4 が形成された後、トレチ 2 の側壁にキャパシタ絶縁膜 2 2 を形成する。キャパシタ絶縁膜 2 2 は、シリコン窒化膜又はこれとシリコン酸化膜の積層膜であり、酸化膜換算で 3 nm 程度の膜厚とする。

更に、As ドープ多結晶シリコンを堆積し、CMP (Chemical Mechanical Polishing) や RIE により、表面が埋め込みブレート 2 4 より下に位置するようにリセスエッティングすることにより、トレチ 2 1 に内にキャパシタノード層（ストレージノード層）2 3 を埋め込む。続いて、キャパシタノード層 2 3 をマスクとしてキャパシタ絶縁膜 2 1 の上部をエッチングする（ここまで、図 1 3 A）。

次に、トレチ 2 上部を軽く酸化した後、厚いシリコン酸化膜 2 5 を堆積し、これを RIE によってトレチ 2 1 の側壁に残す。このシリコン酸化膜 2 5 は、埋め込みブレート 2 4 と後に形成されるトランジスタの n 型拡散層の間で縦型寄生トランジスタが動作するのを防止する働きをする。続いて、再度 As ドープ多結晶シリコンを堆積し、これを CMP や RIE によりシリコン基板 1 の面より下に表面が位置するようリセスして、図 1 3 B に示すように、第 2 のキャパシタノード層 2 6 を埋め込み形成する。

次に、トレチ 2 1 内の多結晶シリコンからなるキャパシタノード層 2 3、2 6 が後の工程で酸化されるのを防止するために、図 1 3 C に示すように、シリコン窒化膜 2 7 とシリコン酸化膜 2 8 を積層形成する。そして、シリコン酸化膜 2 8 を CMP 处理により平坦化した後、RIE によりシリコン酸化膜 2 8 をエッチ

ングして、図13Dに示すように、シリコン酸化膜28の表面位置がシリコン基板1の表面より下に位置するようにする。これは、後のシリコン層エピタキシャル工程で良質のシリコン結晶を得るために必要である。またシリコン酸化膜28は、この後形成されるシリコン層とキャバシタノード層26を分離する、キャバシタノード層26を覆うキャップ絶縁膜となる。

次に、酸化膜1101と窒化膜1102を除去した後、シリコン層3を2μm程度エピタキシャル成長させる。そして表面を平坦化するため、CMP処理を行い、500nm程度のシリコン層3を残す（ここまで、図13E）。このとき、CMPによる平坦化の負担を減らすため、水素アニールを併用してもよい。シリコン層3はキャバシタ2の周囲にあるシリコン基板1の結晶面を種として結晶成長し、トランジスタ形状に適した良質の結晶性を有するものとなる。シリコン層3は成長時はノンドープ（i型）であり、後に説明するようにウェルイオン注入によりp型ウェルが形成される。

次いで、STI（Shallow Trench Isolation）技術による素子分離工程に入る。図13Fに示すように、シリコン酸化膜1103とシリコン窒化膜1104を堆積し、その上に能動素子領域5のレジストパターン（図示せず）をリソグラフィにより形成し、窒化膜1104と酸化膜1103をエンチングする。そして、これらの窒化膜1104と酸化膜1103をマスクとしてシリコン層3をRIEによりエッティングして素子分離溝を形成した後、図13Fに示すように、CVDシリコン酸化膜からなる素子分離絶縁膜4を埋め込む。これにより能動素子領域5は、図1Oに太線で示したように、x方向に隣接する二つのキャバシタ2にまたがり、2Fのスペースをもって細長い島状パターンとして配列され、y方向には1/4ピッチずつずれた状態に配列形成される。

その後、窒化膜1104と酸化膜1103を除去して、素子領域5に犠牲酸化膜（図示せず）を形成する。そして、この犠牲酸化膜を通してウェル形成のイオン注入としきい値調整のイオン注入を行う。これにより素子領域5にはp型ウェルが形成される。犠牲酸化膜を剥離した後、トランジスタ6の形成工程に入る。即ちゲート絶縁膜61を例えばシリコン窒化酸化膜により形成し、その上にゲート電極62をパターン形成する。ゲート電極62は、70nmの多結晶シリコン膜62a、4.5nmの窒化タンゲスタン/タンゲスタン膜62b、及び150nmのシリコン窒化膜64を積層し、これらをリソグラフィでパターン形成することにより形成される。

ゲート電極62は、図1Oに示すように連続的に配設され、これがワード線WLとなる。そしてゲート電極62の側壁にシリコン窒化膜65を形成した後、イオン注入を行って、ソース、ドレインとなるn型拡散層63を形成する。更にエンチングストップ用の薄いシリコン窒化膜66を介して層間絶縁膜となるBPSG膜67を堆積し、CMP処理を行う。これにより、図13Gに示すように、ゲート電極62の間にBPSG膜67が埋め込まれた状態で全体が平坦化される。

次に、キャバシタ・コンタクトとピット線コンタクトを同時に形成する工程に入る。まず、素子領域5の反転パターンのレジストパターン（図示せず）を形成し、図13Hに示すように、素子領域5上のBPSG膜67をエッティングする。更に、BPSG膜67の下の薄いシリコン窒化膜66もRIEによりエッティングして、シリコン層3の表面即ち、n型拡散層63の表面を露出させる。

次いで、図13Iに示すように、キャバシタ2の領域に開口を持つレジストパターン1105を形成し、シリコン窒化膜に対して高選択比を持つエッティング法でシリコンエッティングを行い、露出したシリコン酸化膜28をもエッティングして、

キャパシタノード層 2 6 に対するコンタクト孔 1 1 0 6 を形成する。このとき、コンタクト孔 1 1 0 6 の位置は、図 1 0 のレイアウト上の 1 1 - 1 1' 方向については、ゲート電極 6 2 の間のスペース、即ちゲート電極 6 2 とキャパシタ 2 の位置合わせで決まる。また 1 2 - 1 2' 方向については、素子領域 5 とキャパシタ 2 の位置合わせで決まる。いずれも十分な合わせ余裕があるため、コンタクト孔 1 1 0 6 がキャパシタノード層 2 6 から外れて、コンタクト抵抗が増大する可能性は少ない。

レジストパターン 1 1 0 5 を除去した後、図 1 3 J に示すように、コンタクト孔 1 1 0 6 の側壁に、縦型の寄生トランジスタの動作を防止するためにカラー絶縁膜 1 1 0 7 を形成する。この工程はまず、TEOS 酸化膜をコンタクト孔 1 1 0 6 内に 20 nm 程度堆積し、RIE により側壁のみに残す。更にレジストをコンタクト孔 1 1 0 6 に埋め込み、リセスして、側壁絶縁膜のソース、ドレイン拡散層 6 3 との接続部を露出させる。続いてウエット・エッチングを行って、側壁絶縁膜を除去する。これにより、n 型拡散層 6 3 との接続部を露出させた状態のカラー絶縁膜 1 1 0 7 が形成される。

上のカラー絶縁膜 1 1 0 7 の形成工程で、ピット線コンタクト部にはレジストが残らないため、ウェットエッチング工程で BPSG 膜 6 7 が除去され、コンタクト孔 1 1 0 8 が形成される。そこで次に、As ドープ多結晶シリコンを堆積して CMP 又は RIE により平坦化することにより、図 1 3 J に示すように、トランジスタ 6 の拡散層 6 3 をキャパシタノード層 2 6 に接続するためのキャパシタ・コンタクト層 9 と、ピット線コンタクト層 8 が同時に埋め込み形成される。トランジスタ拡散層 6 3 は、埋め込まれたコンタクト層 9 の上部側面に接続されることになる。

なお、n 型多結晶シリコンからなるコンタクト層 9 と p 型シリコン層 3 との間の接合リーカーを軽減し、またコンタクト層 9 がシリコン層 3 と接触する部分から結晶化するのを防止するため、多結晶シリコン堆積前にコンタクト孔 1 1 0 6 の側壁にごく薄いシリコン塗化膜を形成することも有効である。

最後に、公知のダマシーン法を用いて、図 1 1 及び図 1 2 に示すように、層間絶縁膜 7 1 を介してピット線 7 を形成する。以下、図には示さないが公知の金属配線技術を適用して、DRAM が完成する。

この実施例によると、キャパシタは 1 F 或いはそれ以下の一定スペースをもつて最密配置され、メモリセル面積に対してキャパシタ面積及びキャパシタ周辺長は極大、従ってキャパシタ容量が極大になる。しかもキャパシタ面積が大きく且つ、その形状が対称的であることから、キャパシタ溝加工時のアスペクト比を小さくすることができ、キャパシタ加工が容易である。更に、一辺が 2 F のキャパシタ構造とすることにより、キャパシタノード層に対するトランジスタのコンタクトを形成する際の合わせ余裕が大きく、従って低抵抗のコンタクトが可能になる。

次に第 5 の実施例について説明する。

第 4 の実施例では、n 型層からなる埋め込みプレート 2 4 をシリコン基板 1 の上部に p 型層が残る状態に形成した。これに対して第 5 の実施例では、シリコン基板 1 の上部まで埋め込みプレート 2 4 を形成する。第 4 の実施例の図 1 3 A に対応する断面を、図 1 4 A に示す。

第 4 の実施例と同様に、キャパシタ構造 2 1 を形成する RIE を行った後、埋め込みプレート 2 4 を形成するために、ASG からの固相拡散又は気相 As 拡散を行う。このとき、図 1 4 A に示すように、埋め込みプレート 2 4 はシリコン基板 1 の上部まで形成する。この様になると、第 4 の実施例で必要であったレジストリセス工程 (AS

G 固相拡散を用いた場合) 又はブロック層の形成 (気相 A s 拡散を用いた場合) が不要となるので、工程が簡略化される。

埋め込みプレート 2 4 の形成後、キャバシタ絶縁膜 2 2 を形成し、A s ドープ多結晶シリコンからなるキャバシタノード層 2 3 を埋め込み形成する。キャバシタノード層 2 3 の上端は、シリコン基板 1 の表面より下になるようにし、これより上にあるキャバシタ絶縁膜はウェットエッチングにより除去する。ここまでが、図 1 4 A の状態である。

この後、図 1 4 B に示すように、キャバシタノード層 2 3 の酸化防止用及びキャバシタノード 2 3 の基板の分離用となるシリコン酸化膜 2 8 を堆積する。この酸化膜 2 8 を CMP により平坦化した後、R I E 等により酸化膜 2 8 の表面がシリコン基板 1 の面より下に位置するようにリセスする。そして、酸化膜 1 1 0 1 と窒化膜 1 1 0 2 を剥離した後、図 1 4 C に示すように、シリコン層 3 をエピタキシャル成長させる。シリコン層 3 は、2 μm 程度成長させた後、CMP により平坦化して 5 0 0 n m 程度の厚み残す。このとき、CMP による平坦化の負担を減らすため、水素アニールを併用してもよい。シリコン層 3 はキャバシタ 2 の周囲にあるシリコン基板 1 の結晶面を種として結晶成長するため、キャバシタ 2 の領域上でもトランジスタ形成に適した良質の結晶性を有するものとなる。

以下、第 4 の実施例と同様の工程を経て、DRAM が完成する。図 1 4 D がピット線 7 まで形成した状態の、図 1 1 に対応する断面である。

この実施例によると、埋め込みプレートをシリコン基板の上部まで形成することにより、埋め込みプレートの上部を決定するレジストリセス工程が省略できる。また、2 ステップのキャバシタノード層を埋め込む第 4 の実施例に対して、この実施例ではキャバシタ上部のカーラー酸化膜が不要になり、キャバシタノード層の面積が実施の形態 1 に比べて大きくなり、コンタクト孔に対する許容範囲が大きくなる。

次にこの発明の第 6 の実施例について説明する。

図 1 5 は、第 6 の実施例による DRAM のレイアウトを、図 1 0 に対応させて示している。この実施例では、キャバシタ 2 の配列を市松模様としている。即ち、キャバシタ 2 は、一辺が 2 F の略正方形であり、その辺を x, y 方向に一致させ、x 方向にスペースが 2 F 以上の一定ピッチで且つ、隣接するピット線では順次 1 / 2 ピッチずつずれた状態に配列される。y 方向についても同様に、スペースが 2 F 以上の一定ピッチで且つ、隣接するワード線で順次 1 / 2 ピッチずつずれた状態に配列される。従って、キャバシタ配列は市松模様をなす。その断面構造及び製造工程は、第 4 の実施例或いは第 5 の実施例によるものと同様である。

この実施例によると、キャバシタの面積及び周辺長はメモリセル面積に対して極大となり、大きなキャバシタ容量が得られる。またキャバシタ構成時のアスペクト比が小さく、キャバシタ加工が容易である。更に、大きな面積のキャバシタを用いることにより、トランジスタ拡散層とキャバシタの接続のコンタクトに対する余裕も大きくなる。

次に、トランジスタ拡散層のキャバシタノード層に対するコンタクトを改良した、この発明の第 7 の実施例を説明する。この第 7 の実施例では、シリコン層 3 を 2 回のエピタキシャル成長工程により形成すること、第 1 層シリコン層にキャバシタノード層に達するコンタクト層を埋め込み、第 2 層シリコン層を形成した後トランジスタを形成すること、トランジスタ拡散層はその底面でキャバシタノード層に対するコンタクト層に接すること、等を特徴とする。

DRAM レイアウトは、第 4 の実施例或いは第 6 の実施例と同様であるから説明を省き、製造工程を説明する。第 4 の実施例の図 1 3 F のステップまでは同じ工程をとる。この後の工程が、図 1 6 A ～図 1 6 F である。

図 16 A は、第 1 のシリコン層 3 a を第 7 の実施例と同様にエピタキシャル成長させた後、キャバシタノード層 2 6 に対するコンタクト孔 1 1 0 6 を形成した状態を示している。

この後、図 16 B に示すように、コンタクト孔 1 1 0 6 の内壁にカラー酸化膜 1 1 0 7 を形成する。具体的には、TEOS 酸化膜を 20 nm 程度コンタクト孔 1 1 0 6 内に堆積し、RIE により側壁にカラー酸化膜 1 1 0 7 として残す。次に、リン又は砒素をドープした多結晶シリコンを堆積し、CMP と RIE によるエッチャリングを行って、キャバシタ・コンタクト層 9 として埋め込む。このとき、コンタクト層 9 の表面はシリコン層 3 a の表面より下に位置するようとする。

次に、窒化膜 1 1 0 2 、酸化膜 1 1 0 1 及びカラー酸化膜 1 1 0 7 のコンタクト層 9 の上部に露出する部分を除去した後、図 16 C に示すように、第 2 のシリコン層 3 b をエピタキシャル成長させる。第 2 のシリコン層 3 b の表面は平坦化する。

その後、図 16 D に示すように、第 4 の実施例と同様にしてシリコン酸化膜 1 1 0 3 とシリコン窒化膜 1 1 0 4 のマスクをパターン形成して、STI により素子分離絶縁膜 4 を形成する。素子分離絶縁膜 4 は、好ましくは第 1 のシリコン層 3 a に達する深さに埋め込む。

続いて、窒化膜 1 1 0 4 と酸化膜 1 1 0 3 を除去して、第 4 の実施例と同様に p 型ウェル形成及びしきい値調整のためのイオン注入を行う。その後、図 16 E に示すように、ゲート絶縁膜 6 1 を介してゲート電極 6 2 を形成し、ソース、ドレインのイオン注入を行う。このとき、ソース、ドレイン拡散層は、図 16 E に示すように、ビット線に接続される拡散層 6 3 a 側は先の実施例と同様である。キャバシタノード側の n 型拡散層 6 3 b は、キャバシタノード層 9 からの不純物の上方拡散と上からのイオン注入不純物が重なり、実質的に深くなっている。その底面がキャバシタノード層 9 の上端に接続される。

その後、公知のセルフアライメントコンタクト (SAC) 技術を用いて、n 型拡散層 6 3 a に対するビット線コンタクト層 8 を埋め込み形成し、更に公知のダメーション法によりビット線 7 を形成する。

この実施例によると、トランジスタの拡散層は、キャバシタノード層上に埋め込まれたコンタクト層の上面に接続されることになり、コンタクト面積が大きくなり、安定で低抵抗のコンタクトが得られる。

図 17 は、第 8 の実施例による DRAM の断面を、第 5 の実施例の図 14 C に対応させて示している。シリコン層 3 をエピタキシャル成長させたとき、下地が単結晶でないキャバシタ 2 の上の部分は多結晶となり、図 17 に破線で示すようなファセット 1 2 0 1 が生じる。p 型ウェルの境界 1 2 0 2 がこのファセット 1 2 0 1 に重なると、リーカ電流の原因となる。特に n 型層である埋め込みブレーント 2 4 が境界 1 2 0 2 と重なる状態のとき、その接合面がファセット 1 2 0 1 と重なると、p 型ウェルと埋め込みブレーント 2 4 の間の p-n 接合でリーカ電流が増大する。

そこでこの実施例では、図 17 に示すように、ウェル境界 1 2 0 2 がファセット 1 2 0 1 に重ならないようにする。具体的には、p 型ウェル形成時、高加速イオン注入により、急峻な不純物濃度分布をもつように深さコントロールを行う。これにより、リーカ電流の増大を防止することができる。

次に、第 5 の実施例と同様のキャバシタ構造を用いて、キャバシタノード層とトランジスタ拡散層の接続に埋め込みストラップ方式を適用した、この発明の第 9 の実施例を説明する。

図 1 8 はこの第 9 の実施例の D R A M のレイアウトを、図 1 0 に対応させて示している。基本的なレイアウトは図 1 0 と同様であるが、図 1 0 ではトランジスタ拡散層とキャパシタノードを接続するコンタクト層 9 がキャパシタ 2 のほぼ中に配置されていたのにに対し、この第 9 の実施例ではキャパシタ 2 の中心から x 方向にずれて、素子分離領域近くに配置されている点が異なる。これは、埋め込みストラップによる接続を確実にするための配慮である。

図 1 9 A ～図 1 9 F は、この第 9 の実施例の D R A M 製造工程を、図 1 8 の 1 9 ～ 1 9' 断面を用いて示したものである。図 1 4 C までの工程は第 5 の実施例と同じであり、この後、図 1 9 A に示すように、シリコン酸化膜 1 3 0 1 とシリコン塗化膜 1 3 0 2 のマスクを用いて、キャパシタノード層 2 3 に対するコンタクト孔 1 1 0 6 を加工する。図示のように、コンタクト孔 1 1 0 6 は、キャパシタ 2 の中心から外側にずれている。

次に、図 1 9 B に示すように、コンタクト孔 1 1 0 6 の内壁にカラー酸化膜 1 1 0 7 を形成する。具体的には、T E O S 酸化膜を 2 0 n m 程度コンタクト孔 1 1 0 6 内に堆積し、R I E により側壁にカラー酸化膜 1 1 0 7 として残す。次に、リン又は砒素をドープした多結晶シリコンを堆積し、C M P と R I E によるエッチングを行って、コンタクト層 9 a として埋め込む。このとき、コンタクト層 9 a の表面はシリコン層 3 a の表面より 1 5 0 n m 程度下に位置するようとする。

続いて、コンタクト層 9 a の上部に露出するカラー酸化膜 1 1 0 7 をウェットエッチングにより除去し、斜めイオン注入を行って、図 1 9 C に示すように、コンタクト孔 1 1 0 6 の上部側壁に、後に形成されるトランジスタ拡散層に接続される n 型拡散層（埋め込みストラップ）1 3 0 3 を形成する。次に再度、砒素又はリンがドープされた多結晶シリコンを堆積し、C M P と R I E によりリセッティングして、コンタクト孔 1 1 0 6 の上部に第 2 のコンタクト層 9 b を埋め込む。このコンタクト層 9 b の表面は、シリコン基板表面から 7 0 n m 程度下に位置するようになる。

その後、S T I 技術により、図 1 9 D に示すように素子分離溝を加工し、図 1 9 E に示すように素子分離絶縁膜 4 を埋め込む。素子分離溝は、能動素子領域 5 の外側にも形成される無用な埋め込みストラップ 1 3 0 3 を削り取るように、コンタクト層 9 b, 9 a の外側上部にかかるように形成される。素子分離絶縁膜 4 は、シリコン層表面にはほぼ一致する表面を持つように埋め込むことにより、コンタクト層 9 a の表面を絶縁膜 4 a で覆った状態とする。

その後、ウェル形成やしきい値調整用のイオン注入工程を経た後、第 8 の実施例と同様、図 1 9 F に示すように、トランジスタ 6 を形成する。トランジスタ 6 のソース、ドレイン拡散層 6 3 のうち、キャパシタノード側の拡散層 6 3 b は、埋め込みストラップ 1 3 0 3 を介し、更にコンタクト層 9 b, 9 a を介してキャパシタノード層 2 3 に接続される。この後は図を示さないが、ピット線コンタクトのセルフアライン埋め込みを行い、更にダマシーン法によるピット線形成を行う。

この実施例によると、キャパシタ 2 上に埋め込み形成されたコンタクト層 9 に対して埋め込みストラップ方式でトランジスタ拡散層を接続することができる。この場合、コンタクト層 9 の位置をキャパシタ 2 の中心位置から x 方向に素子分離領域側にずらしており、これによりトランジスタ拡散層との合わせ余裕を確保することができる。

なおこの実施例の埋め込みストラップ方式は、図 1 5 に示すキャパシタレイアウトの場合にも同様に適用することが可能である。

図 20 は、トランジスタとキャパシタの接続に表面ストラップ方式を採用した、この発明の第 10 の実施例によるDRAMレイアウトを示し、図 21 及び図 22 はそれぞれ、図 20 の断面を示している。キャパシタレイアウトについては第 4 の実施例と同様のレイアウトを採用し、キャパシタ構造については第 5 の実施例と同様の構造を採用している。

図 20 のレイアウトにおいて、図 10 と異なる点は、トランジスタ 6 をキャパシタ 2 のノードに接続するための埋め込みコンタクト層 9 が、キャパシタ 2 の中心からワード線 WL の方向にずれた位置に形成されていることである。言い換えれば、コンタクト層 9 は、正方形のキャパシタ 2 の対角線上に形成される能動素子領域 5 に対して、略半分重なる状態で形成される。そして、図 21 及び図 22 に示すように、トランジスタ 6 のキャパシタ 2 に接続されるべき拡散層 6 3 とコンタクト層 9 と間をそれらの表面に形成した接続導体 10 により接続している。

その具体的な製造工程を、図 21 の断面に対応する図 23 A～図 23 H の工程断面図を用いて説明する。図 23 A は基本的に図 21 と同様であり、キャパシタ 2 が形成された基板にシリコン層 3 をエピタキシャル成長させた後、キャパシタ 2 に対するコンタクト孔 1 1 0 6 を形成した状態を示している。コンタクト孔 1 1 0 6 は、図 23 A の断面ではキャパシタ 2 の略重心にあるが、これと直交する WL 方向の断面ではキャパシタ 2 の中心からはずれて、図 20 にコンタクト層 9 として示した位置に形成される。

この後、図 23 B に示すようにコンタクト孔 1 1 0 6 に先の実施例と同様にしてカラー酸化膜 1 1 0 7 を形成し、砒素又はリンドープの多結晶シリコンによるコンタクト層 9 を埋め込む。コンタクト層 9 の面位置は、シリコン層 3 の表面から 50 nm 程度下にあるようとする。

その後、STI 技術により、図 23 C に示すように素子分離溝を加工し、図 23 D に示すように素子分離絶縁膜 4 を埋め込む。素子分離絶縁膜 4 は、シリコン層表面にはほぼ一致する表面を持つように埋め込むことにより、コンタクト層 9 の表面を絶縁膜 4 a で覆った状態とする。

その後、シリコン酸化膜 1 3 0 1 とシリコン窒化膜 1 3 0 2 は剥離し、犠牲酸化膜を形成してウェル形成及びしきい値調整のイオン注入を行う。そして犠牲酸化膜を剥離して、図 23 D に示すようにゲート酸化膜 6 1 を形成する。

この後、図 23 E に示すように、先の第 4 ないし第 9 の各実施例と同様の工程でトランジスタ 6 を形成する。トランジスタ 6 のゲート電極 6 2 の間は層間絶縁膜 6 7 により平坦に埋め込まれる。

次に、ビット線コンタクトと表面ストラップを同時に形成するため、図 23 F に示すように能動素子領域 5 の反転パターンのレジスト 1 4 0 1 を形成し、これを用いて能動素子領域 5 上のゲート電極 6 2 間にある層間絶縁膜である BPSG 膜 6 7 をエッチング除去する。更に、除去した層間絶縁膜 6 7 の下に露出したシリコン窒化膜 6 6 、ゲート酸化膜 6 1 、更にコンタクト層 9 を覆っている絶縁膜 4 a をエッチングして、図 23 G に示すように、コンタクト層 9 及びビット線を接続する拡散層 6 3 の面を露出させる。このとき、コンタクト層 9 上の開口は、能動素子領域 5 に整合されているから、図の断面に直交するワード線方向については、図 20 から明らかのように、コンタクト層 9 の上面の半分を露出させた状態となる。

この後、砒素又はリンドープの多結晶シリコンを堆積し、CMP により平坦化して、図 23 H に示すようにビット線コンタクト層 8 と同時に、キャパシタ 2 とトランジスタを接続する接続導体としての表面ストラップ 10 を埋め込み形成する。

ワード線方向については、図 2 2 の断面に示すように、表面ストラップ 1 0は、トランジスタ 6 の拡散層 6 3 とコンタクト層 9 にまたがって形成され、これらを接続する。

この後は図示しないが、先の各実施例と同様にダマシーン法によりビット線 7 を形成する。

この実施例では、トランジスタ形成後にキャパシタとトランジスタが表面ストラップにより接続されるので、ストラップ形成後の熟工程が少なく、シリコン層 3 に結晶欠陥が入りにくい。また、表面ストラップであるため、多結晶シリコンであるコンタクト層 9 と能動領域のシリコン層 3 の接触面積が小さく、これも結晶欠陥の導入を抑える。更に、図 2 0 に示したように、コンタクト層 9 はキャパシタ 2 の中心からはずれた位置に埋め込まれるが、キャパシタ面積が大きいから、表面ストラップ 1 0 はコンタクト層 9 と拡散層 6 3 を低抵抗で接続することができる。

図 2 4 は、第 1 0 の実施例でのレイアウトを変更した、第 1 1 の実施例のレイアウトである。第 1 0 の実施例では、能動素子領域 5 の中心がキャパシタ 2 の対角線上を横切るように、従ってキャパシタ 2 の中心を通ようにレイアウトした。このため、キャパシタ 2 とトランジスタ 6 を接続するコンタクト層 9 をキャパシタ 2 の中心からはずらして配置している。これに対し、図 2 4 では、コンタクト層 9 をキャパシタ 2 の中心に配置している。その結果として、能動素子領域 5 は、キャパシタ 2 の対角線上から y 方向にずれて、コンタクト層 9 を分断するようにレイアウトしている。

この様なレイアウトを採用することにより、コンタクト層 9 とキャパシタ 2 の合わせズレに対する余裕が大きくなる。即ちこの合わせズレが多少あったとしても、コンタクト層 9 がキャパシタ 2 の領域外のシリコン層と短絡する事態は確実に防止される。

図 2 5 は、単位セルの面積をより小さくした、この発明の第 1 2 の実施例のDRAM レイアウトである。ここまで実施例では能動素子領域 5 の x 方向の大きさを 6 F としたのに対し、この実施例では能動素子領域 5 の x 方向配列は、大きさが 5 F 、スペースが 1 F としている。y 方向には 1 / 3 ピッチずつずれる。

ビット線 BL 及びワード線 WL をライン / スペース = 1 F / 1 F で形成するとして、キャパシタ 2 は、破線で示すように、各能動素子領域 5 の両端部に、x 方向の大きさ 1 F 、y 方向の大きさ 2 F の長方形として配置される。断面構造及び製造工程については説明を省くが、第 4 の実施例或いは第 5 の実施例のいずれを用いてもよい。

この実施例の場合、ビット線 BL 方向にワード線 WL の配列をみると、トランジスタ 6 を駆動する 2 本のアクティブワード線に対して通過ワード線 1 本という割合で配置される。単位セルの大きさは、ビット線方向に 3 F 、ワード線方向に 2 F であり、6 F 2 となる。現在一般に用いられているDRAM セルアレイは、ワード線方向に 4 F 、ビット線方向に 2 F である。これと比較すると、同じデザインルールであれば、メモリセル面積を縮小することができ、同じメモリセル面積とすればデザインルールを緩くすることができる。

従来の技術では、トランジスタとキャパシタの間のコンタクトと、ワード線との間で合わせ余裕が必要であったため、完全な 6 F 2 のメモリセルを実現することが困難であった。この発明の場合、ワード線とキャパシタ・コンタクトを自己整合的に形成することができるため、6 F 2 の大きさのメモリセルを容易に実現することができる。

次にこの発明の第13の実施例について説明する。

第4の実施例では、キャパシタ・コンタクト層9とピット線コンタクト層8を別工程で埋め込んだのに対し、この実施例ではセルフアラインコンタクト技術を用いてこれらを同時に埋め込み形成し、且つキャパシタのコンタクト層9とn型拡散層の接続を表面ストラップ方式により行う。その製造工程を、図26A～図26Dを用いて説明する。

なお、キャパシタ構造については、第5の実施例と同じ構造を用いているが、第4の実施例の構造を用いることも可能である。

第4の実施例或いは第5の実施例と同様にして、基板1にキャパシタ2を形成し、シリコン層3をエピタキシャル成長させ、素子分離を行ってトランジスタ6を形成する。この後、素子領域5の反転パターンのレジストを用いて、層間絶縁膜6.7をRIEによりエッチング除去する。更にゲート電極間に露出したシリコン窒化膜を除去してn型拡散層6.3を露出させた後、20～30nmの薄いシリコン酸化膜1402を堆積し、これをゲート側壁に残す。この状態が図26Aである。

この後、キャパシタのコンタクト部分に開口を持つレジスト1403をリソグラフィによりパターン形成し、シリコン窒化膜に対して選択比の大きいエッチング法でシリコンエッチングを行い、図26Bに示すようにキャパシタ2に対するコンタクト孔1106を形成する。コンタクト孔1106の底部に露出する酸化膜28をエッチングして、コンタクト孔1106の底部にキャパシタノード層23を露出させる。

次に、ゲート側壁のシリコン酸化膜1402をウェットエッチングにより除去した後、コンタクト孔1106の内部に熱酸化により15nm程度のカラー酸化膜1107を形成する。更にカラー酸化膜1107の上部をエッチングし、同時にキャパシタ・コンタクト部及びピット線コンタクト部の素子領域表面の酸化膜を除去する。この状態が図26Cである。このとき、図示のように、コンタクト孔1106の上部周囲には、素子領域のn型拡散層6.3の表面が露出する。

この後、砒素ドープ又はリンドープ多結晶シリコンを堆積し、CMPで平坦化して、図26Dに示すように、キャパシタ・コンタクト層9とピット線コンタクト層8を同時に埋め込み形成する。

その後は先の実施例と同様にピット線及び金属配線を形成して、DRAMを完成する。

この実施例によると、キャパシタ・コンタクト層9は、その上部がコンタクト孔開口後の側壁酸化膜除去工程によって露出したn型拡散層6.3の表面にコンタクトしており、表面ストラップとなる。即ち、コンタクト孔周囲に素子領域の空き領域が形成されて、表面ストラップがピット線コンタクトと同時に形成される。

次にこの発明の第14の実施例について説明する。

ここまで実施例では、能動素子領域を形成する半導体層として、キャパシタが形成された基板上にエピタキシャル成長させたシリコン層3を用いた。これに対してこの実施例では、能動素子領域として一層結晶性のよい半導体層を用いるために、キャパシタが形成されたシリコン基板上にシリコン基板を貼り合わせる直接接着技術を用いる。貼り合わせにより得られたSOI基板に、キャパシタノードに接続するためのコンタクト層を埋め込み形成し、その上に更にシリコン層をエピタキシャル成長させて、能動素子領域を形成する。

図27はこの実施例のDRAMの断面構造を示している。キャパシタ2のレイアウトは第4の実施例或いは第6の実施例と同じである。キャパシタ構造は第5

の実施例と同様の構造の場合を示しているが、第4の実施例のようなキャパシタ構造でもよい。

図27の構造において、酸化膜1303と1304の境界が基板接着面であり、その上のシリコン層(SOI層)1301が接着されたシリコン基板を研磨して残されたバルクシリコン層である。酸化膜1303と1304は基板分離用絶縁膜となっている。その具体的な製造工程を図28A～図28Fを参照して、以下に説明する。

シリコン基板1は、(100)配向をもった、不純物濃度 $1 \sim 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ 程度のp型シリコン基板（又はその表面にp型エピタキシャル層を $1 \mu\text{m}$ 程度成長させたエピタキシャル基板）である。この基板1の図示しない周辺回路領域には、PMOSトランジスタ領域、NMOSトランジスタ領域にそれぞれn型ウェル、p型ウェルを形成する。その後メモリセルアレイ領域に、先の各実施例と同様、図28Aに示すようにキャパシタ2を形成する。キャパシタ2のキャパシタノード層23は、トレンド加工にマスクとして用いられたシリコン窒化膜1102の表面位置に合わせた面位置に埋め込まれる。

この後、図28Bに示すように、キャパシタノード層23の表面をキャップ絶縁膜28により覆う。キャップ絶縁膜28には、CVD酸化膜、熱酸化膜或いはシリコン窒化膜を用い得る。次に、キャップ絶縁膜28で覆われた基板を平坦化するCVDシリコン酸化膜1303を形成する。具体的には、 300 nm 程度のシリコン酸化膜を堆積し、CMPにより平坦化する。

この後、SOI層の形成を行う。即ち、第2のシリコン基板を用意し、その表面に貼り合わせを行うための絶縁膜（図28Bに示す酸化膜1304）として、熱酸化膜を 100 nm 程度形成し、好ましくは更に、BPSG（又はCVDSiO₂）膜を 200 nm 程度堆積して平坦化する。そして、この第2のシリコン基板をその酸化膜1304側を第1のシリコン基板1の酸化膜1303に接する状態に重ねて、 900°C 程度の加熱条件下で直接接着する。酸化膜1304としてBPSG膜を用いると、比較的低温で良好な密着性が得られること、またキャップ絶縁膜28にシリコン窒化膜を用いた場合に、後のコントラクト孔形成工程でエッチングステップの制御が容易になること、等の点で好ましい。

この後、貼り合わせた第2のシリコン基板を研磨し、エッチングして、 150 nm 程度のシリコン層1301として残し、SOI基板を得る。図28Bはこの状態を示している。このSOI基板のシリコン層1301の表面は、後のトランジスタ形成に耐えられるように、鏡面研磨されているものとする。なお、SOI基板の形成方法として、上の例に限られず、イオン注入法を用いる方法等、他の方法を用いることもできる。

次に、図28Cに示すように、シリコン層1301の表面にシリコン酸化膜1305を例えれば熱酸化法により 50 nm 程度形成する。そして、リソグラフィとRIEによりエッチングを行って、キャパシタ2の領域にキャパシタノード層23に対するコントラクト孔1106を加工する。酸化膜1305は、レジストプロセス及びエッチングプロセスにおけるシリコン層1301の表面汚染を防止する。コントラクト孔1106の加工は、まずシリコン層1301をエッチングし、露出した酸化膜1304、1303をエッチングし、更にキャップ絶縁膜28をエッチングして、キャパシタノード層23の面を露出させる。このときキャップ絶縁膜28としてシリコン窒化膜を用いていれば、これが酸化膜1304、1303のエッチング時のストップとなる。

形成されたコントラクト孔1106の側壁に次に、 30 nm 程度のCVDシリコ

ン酸化膜 1 1 0 7 を形成する。これは、全面に C V D シリコン酸化膜を堆積した後、R I E により側壁のみに残す方法で形成する。その後、砒素ドープの多結晶シリコンを堆積し、C M P と R I E により、コンタクト孔 1 1 0 6 内にコンタクト層 9 として埋め込む。酸化膜 1 3 0 5 はこの C M P と R I E の間、シリコン層 1 3 0 1 を保護する。こうして得られた状態が、図 2 8 C である。コンタクト層 9 は例えば、シリコン基板 1 の表面から 0.4 μ m 程度上に出るようになる。

5 この後、酸化膜 1 3 0 5 をエッティング除去し、図 2 8 D に示すように、シリコン層 1 3 0 1 上にシリコン層 1 3 0 2 を 60 nm 程度エピタキシャル成長させる。S O I 基板のシリコン層 1 3 0 1 とこの上にエピタキシャル成長させたシリコン層 1 3 0 2 の二層が、先の各実施例における能動素子形成用のシリコン層 3 に相当することになる。

10 シリコン層 1 3 0 2 は必要に応じて、C M P 等の方法で研磨して凹凸のない平坦面とする。この様にすると、コンタクト孔 1 1 0 6 内の多結晶シリコンであるコンタクト層 9 上に成長した部分と単結晶シリコン層 1 3 0 1 上に成長した部分の厚みの相違による凹凸をなくすことができ、その後形成されるトランジスタの品質向上が図られる。

15 また図には示さないが、シリコン層 1 3 0 2 の成長工程前に、トランジスタのパンチスルーアーチ防止のために深いチャネルイオン注入を行ってもよい。これにより、パンチスルーアーチ防止のための理想的なチャネル不純物プロファイルをトランジスタ領域に形成することができる。

20 この後、図 2 8 E に示すように、S T I 技術により素子分離絶縁膜 4 を形成する。即ち、シリコン酸化膜 1 1 0 3 とシリコン窒化膜 1 1 0 4 の積層膜マスクをパターン形成し、R I E によりシリコン層 1 3 0 1, 1 3 0 2 に 20 nm 程度のトレンチを加工した後、C V D-T E O S 酸化膜の堆積と平坦化により、素子分離絶縁膜 4 を埋め込む。

25 次に、シリコン窒化膜 1 1 0 4 と酸化膜 1 1 0 3 を除去した後、通常のトランジスタ工程に入る。即ち図 2 8 F に示すように、ゲート絶縁膜を介してゲート電極 6 2 を形成し、ソース、ドレインとなる n 型拡散層 6 3 を形成する。ゲート電極 6 2 は、多結晶シリコン膜 (50 nm) とタンゲステン・シリサイド膜 (50 nm) の積層膜とする。具体的にはこの積層膜上に更にキャップ絶縁膜としてのシリコン窒化膜 6 4 をパターン形成し、これをマスクとして、タンゲステン・シリサイド膜と多結晶シリコン膜を順次エッティングする。但し、ゲート電極として多結晶シリコン単層でもよいし、他の積層構造を用いることもできる。

30 図 2 8 F では、通常のシングル・ソース/ドレイン構造を示しているが、これを L D D 構造とすることもできる。その場合には、図 2 8 F の状態では、例えばリンのイオン注入を、加速電圧 70 K e V 、ドーズ量 $4 \times 10^{13} \text{ cm}^{-2}$ 程度の条件で行って低濃度の n 型拡散層を形成する。そして、図 2 7 に示すように、ゲート電極 6 2 の側壁に側壁絶縁膜 6 9 を形成した状態で、砒素イオン注入を例えば、加速電圧 30 K e V 、ドーズ量 $5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-2}$ の条件で行って、高濃度 n 型拡散層を形成する。

35 このトランジスタ形成工程で、一つの素子領域に二つ形成されるトランジスタの拡散層 6 3 のうち、キャパシタに接続されるべき拡散層 6 3 は、丁度キャパシタ 2 上のコンタクト層 9 に位置し、コンタクト層 9 に対して底面が接続されることになる。実際には、コンタクト層 9 から上方への n 型不純物拡散が、上からのソース、ドレイン n 型拡散層と重なり、低抵抗の接続が可能となる。

40 トランジスタ形成後、図 2 7 に示すように、全面に C V D シリコン窒化膜 6 6

を 30 nm 程度堆積し、更に層間絶縁膜 6 7 として BPSG 膜を堆積する。これらの膜堆積後、N₂ 雰囲気中で 800°C、30 分程度のデンシファイ熱処理を行う。この熱工程は、ソース、ドレインの不純物活性化を兼ねて行つてもよい。ソース、ドレインの拡散深さを抑えたい場合には、熱処理の温度を 750°C 程度の低温とし、950°C、10 秒程度の R T A (R a p i d T h e r m a l Anneal) プロセスを併用する。層間絶縁膜 6 7 はその後、CMP により平坦化する。

次に、ピット線コンタクト領域にコンタクト孔を開口し、砒素ドープ多結晶シリコンを埋め込んでピット線コンタクト層 8 とする。統いて、図には示さないが、ソース、ドレイン、ゲート電極へのコンタクト孔を形成し、ピット線 7 を形成する。更に、層間絶縁膜を堆積し、金属配線を形成した後、全面にバシベーション膜を形成して、DRAM が完成する。

この実施例によると、SOI 基板とエビタキシャル成長技術を組み合わせることにより、キャバシタ上に重ねられるトランジスタを形成する能動素子領域の結晶欠陥を低減できる。より具体的には、キャバシタ上に形成されるトランジスタのゲート酸化膜の欠陥を抑えて、信頼性の高い DRAM を得ることが可能になる。

次にこの発明の第 1 5 の実施例について説明する。

第 1 4 の実施例において、素子分離絶縁膜 4 は、シリコン層 1302 を成長させた後に形成される一層の埋め込み絶縁膜である。これに対して第 1 5 の実施例においては、STI 技術による 2 段階の埋め込みによる素子分離構造を用いる。

図 29 は、図 10 の DRAM レイアウトを用いた場合の第 1 の素子分離絶縁膜 4 1 の埋め込みの様子を示すレイアウトであり、図 30 は第 1 の素子分離絶縁膜 4 1 を形成した後、シリコン層 1302 をエビタキシャル成長させた状態を示す断面図である。

第 1 の素子分離絶縁膜 4 1 は、図 29 に示すように、x 方向の素子分離領域のみに埋め込み形成され、この段階で y 方向の素子分離は行われない。第 1 の素子分離絶縁膜 4 1 は、図 30 に示すように、シリコン層 1301 の底面の酸化膜 1304 に達する深さに埋め込まれる。そして、第 1 の素子分離絶縁膜 4 1 の一部を貫通するように、キャバシタノード層への接続用コンタクト孔を加工し、側壁絶縁膜 1107 を形成した後、コンタクト層 9 を埋め込む。その後、シリコン層 1302 をエビタキシャル成長させる。

この後、第 2 の素子分離絶縁膜 4 2 をやはり STI 技術により埋め込む。図 31 はその第 2 の素子分離絶縁膜 4 2 のレイアウトを示している。即ち、第 2 の素子分離絶縁膜 4 2 は、x、y 方向の素子分離領域を全て連結した状態で、且つ x 方向の素子分離領域では第 1 の素子分離絶縁膜 4 1 のエッジより外側にあるように埋め込まれる。図 32 が図 31 の断面図であり、第 2 の素子分離絶縁膜 4 2 は第 1 の素子分離絶縁膜 4 1 より浅く埋め込まれている。

図 33 はこの様な 2 ステップの素子分離絶縁膜構造を用いた基板にトランジスタを形成した状態の断面図である。

この実施例によると、隣接するメモリセルのキャバシタノードが対向する x 方向の素子分離領域に、底部酸化膜に達する深い第 1 の素子分離絶縁膜 4 1 を形成することにより、x 方向に隣接するキャバシタノード間の短絡やリーキーを確実に防止することが可能になる。また、第 2 の素子分離絶縁膜 4 2 は、図 32 から明らかのように、x 方向については第 1 の素子分離絶縁膜 4 1 のエッジより外側に形成されるから、トランジスタの n 型拡散層 6 3 とコンタクト層 9 との接続面積を大きく確保することができる。これにより、工程のゆらぎ等があった場合にも、

キャパシタとトランジスタの接続を低抵抗で且つ安定に行うことができる。

なお、この様な2段階のSTIによる素子分離構造は、DRAMの限らず、その他の各種半導体集積回路に適用することができる。即ち、一定の電気的導通を維持しながら素子分離を行う箇所に浅いSTI1分離膜を形成し、リーコやラッチアップ防止のため電気的導通を完全に遮断したい箇所には底部絶縁膜に達する深いSTI1分離膜を形成することにより、所望の特性の集積回路を得ることが可能になる。

10 While the invention has been described in detail with reference to the appended drawings, the invention is limited in scope only by the claims. Moreover, any patent or publication cited herein should be construed to be incorporated by reference as to any subject matter deemed essential to the present disclosure.

WHAT IS CLAIMED IS:

1. 半導体基板と、この半導体基板上に形成された第1導電型の第1半導体領域と、この第1半導体領域上に形成され、前記第1導電型とは反対導電型である第2導電型の第2半導体領域と、トレンチを有するトレンチキャパシタであって、前記トレンチは前記第1半導体領域及び前記第2半導体領域を通過し、前記トレンチキャパシタの上部が前記第2半導体領域の上表面には到達しないように形成され、前記トレンチ内には導電体トレンチフィルが形成されるトレンチキャパシタと、それぞれが前記第2半導体領域上に形成された一対のゲート電極であり、それぞれが前記トレンチキャパシタの上方に位置している一対のゲート電極と、前記一対のゲート電極のそれぞれを覆うように形成された一対の絶縁層と、前記一対の絶縁層のそれぞれに自己整合するように前記一対の絶縁層相互間に形成された導電層であり、この導電層の先端は前記第2半導体領域とは絶縁された状態で前記第2半導体領域の内部に達しており、かつ前記導電層は前記トレンチキャパシタの前記導電体トレンチフィルと電気的に接続されている導電層と、前記導電層を中心にして互いに対向するように配置され、それぞれが前記導電層と直接に接触する。前記第2半導体領域内に形成された第1導電型の一対の第3半導体領域であって、この一対の第3半導体領域のそれぞれは前記一対のゲート電極のそれぞれを有するトランジスタのソース、ドレインのいずれか一方を構成し、前記一対の第3半導体領域のそれぞれは実質的に一様な深さで形成されている一対の第3半導体領域と、有する半導体記憶装置。
 2. 半導体基板と、この半導体基板に一定ピッチで配列形成され複数のトレンチキャパシタと、これらのトレンチキャパシタが形成された半導体基板上に形成された半導体層と、この半導体層に埋め込み形成されて、隣接する二つのトレンチキャパシタにまたがる複数の能動素子領域を区画する素子分離絶縁膜と、前記各能動素子領域に、ソース、ドレイン拡散層の一方を共有し他方が隣接する二つのトレンチキャパシタの領域上に位置するように2個ずつ形成されて、ゲートが一方向に連続するワード線に接続された複数のトランジスタと、前記各トランジスタの前記ソース、ドレイン拡散層の他方を対応する前記トレンチキャパシタのキャパシタノード層に接続するコンタクト層と、前記ワード線と交差して配設されて前記トランジスタのソース、ドレイン拡散層の一方に接続されたピット線と、有する半導体記憶装置。
 3. 前記トレンチキャパシタは、最小加工寸法をFとして一辺が2Fの略正方形であり、その正方形の対角線の方向を前記ワード線とピット線の直交二方に一致させて、その正方形の直交する二辺の方向にスペースが1F以下の一定ピッチで配列されている請求項2記載の半導体記憶装置。
 4. 前記トレンチキャパシタは、最小加工寸法をFとして一辺が2Fの略正方形であり、その正方形の辺の方向を前記ワード線とピット線の直交二方向に一致させ、ピット線方向にスペースが2F以上の一定ピッチで且つ、隣接するピット線では順次1/2ピッチずつずれた状態に配列されている請求項2記載の半

導体記憶装置。

5 5. 前記能動素子領域は、前記ピット線方向に一定ピッチで且つ隣接するピット線で順次 $1/4$ ピッチずつずれた状態に配列される請求項3記載の半導体記憶装置。

6. 前記コンタクト層は、前記トランジスタ形成後に前記ソース、ドレイン拡散層の他方を貫通して前記キャパシタノード層に達するように埋め込み形成されている請求項2記載の半導体記憶装置。

7. 前記半導体層は、第1のエピタキシャル成長層とこの上に形成された第2のエピタキシャル成長層とからなり、

10 前記コンタクト層は、前記第2のエピタキシャル成長層の形成前に前記第1のエピタキシャル成長層に前記キャパシタノード層に達するように埋め込み形成され、

前記ソース、ドレイン拡散層は前記第2のエピタキシャル成長層形成後に形成されて、前記ソース、ドレイン拡散層の他方の底面が前記コンタクト層の上面に接続される請求項2記載の半導体記憶装置。

15 8. 前記コンタクト層は、前記トランジスタ形成前に前記半導体層に前記キャパシタノード層に達するように埋め込み形成され、前記ソース、ドレイン拡散層の他方は、前記コンタクト層の上部側方に形成された埋め込み拡散層を介して前記コンタクト層に接続されている請求項2記載の半導体記憶装置。

9. 前記コンタクト層は、前記トランジスタ形成前に前記半導体層に前記キャパシタノード層に達するように埋め込み形成され、前記ソース、ドレイン拡散層の他方は、その表面に形成された接続導体を介して前記コンタクト層の上面に接続されている請求項2記載の半導体記憶装置。

10. 前記半導体層は、前記キャパシタが形成された半導体基板に貼り合わせられた別の半導体基板のバルク半導体層と、このバルク半導体層に形成されたエピタキシャル成長層とからなり、

前記コンタクト層は、前記エピタキシャル成長層の形成前に前記バルク半導体層に前記キャパシタノード層に達するように埋め込み形成され、

前記ソース、ドレイン拡散層は前記エピタキシャル成長層形成後に形成されて、前記ソース、ドレイン拡散層の他方の底面が前記コンタクト層の上面に接続される請求項2記載の半導体記憶装置。

11. 前記半導体基板とこれに貼り合わされた別の半導体基板の貼り合せ面には基板分離用絶縁膜が介在し、

前記素子分離絶縁膜は、ピット線方向の素子分離領域に前記基板分離用絶縁膜に達する深さに埋め込み形成された第1の素子分離絶縁膜と、この第1の素子分離絶縁膜と一部重なりピット線方向とワード線方向の素子分離領域に第1の素子分離絶縁膜より浅く埋め込み形成された第2の素子分離絶縁膜を有する請求項10記載の半導体記憶装置。

12. 半導体基板と、この半導体基板に能動素子領域を区画するために埋め込み形成された、第1の絶縁膜とこれより浅い第2の絶縁膜とからなる素子分離絶縁膜と、

この素子分離絶縁膜により区画された前記能動素子領域に形成された素子と有する半導体装置。

13. 半導体基板に、キャパシタノード層がキャップ絶縁膜で覆われた状態で且つそのキャップ絶縁膜表面が前記半導体基板の表面より下に位置するよう、複数のトレンチキャパシタを一定ピッチで配列形成する工程と、

- 前記トレンチキャパシタが形成された半導体基板上に半導体層をエピタキシャル成長させる工程と、
前記半導体層に素子分離絶縁膜を形成することにより、各能動素子領域が隣接する二つのトレンチキャパシタにまたがるように複数の能動素子領域を区画する工程と、
前記各能動素子領域に二つずつのトランジスタをそのソース、ドレイン拡散層の一方を共有し、他方が前記トレンチキャパシタ上に位置するように、且つゲート電極が一方向に連続するワード線となるように形成する工程と、
前記ゲート電極の間に前記ソース、ドレイン拡散層の他方を貫通して前記キャパシタノード層に達するコンタクト層を埋め込む工程と、
前記ソース、ドレイン拡散層の一方に接続されて前記ワード線と交差するようビット線を形成する工程と
を有する半導体記憶装置の製造方法。
14. 半導体基板に、キャパシタノード層がキャップ絶縁膜で覆われた状態で且つそのキャップ絶縁膜表面が前記半導体基板の表面より下に位置するよう、複数のトレンチキャパシタを一定ピッチで配列形成する工程と、
前記トレンチキャパシタが形成された半導体基板上に第1の半導体層をエピタキシャル成長させる工程と、
前記第1の半導体層に前記キャパシタノード層に達するコンタクト層を埋め込む工程と、
前記コンタクト層が埋め込まれた第1の半導体層上に第2の半導体層をエピタキシャル成長させる工程と、
前記第2の半導体層に素子分離絶縁膜を形成することにより、各能動素子領域が隣接する二つのトレンチキャパシタにまたがるように複数の能動素子領域を区画する工程と、
前記各能動素子領域に二つずつのトランジスタをそのソース、ドレイン拡散層の一方を共有し、他方が前記コンタクト層の上面に接続されるように、且つゲート電極が一方向に連続するワード線となるように形成する工程と、
前記ソース、ドレイン拡散層の一方に接続されて前記ワード線と交差するようビット線を形成する工程と
を有する半導体記憶装置の製造方法。
15. 半導体基板に、キャパシタノード層がキャップ絶縁膜で覆われた状態で且つそのキャップ絶縁膜表面が前記半導体基板の表面より下に位置するよう、複数のトレンチキャパシタを一定ピッチで配列形成する工程と、
前記トレンチキャパシタが形成された半導体基板上に半導体層をエピタキシャル成長させる工程と、
前記半導体層に前記トレンチキャパシタのキャパシタノード層に達するコンタクト層をその上端部が前記半導体層に形成される不純物拡散層に接続された状態に埋め込み形成する工程と、
前記半導体層に素子分離絶縁膜を形成することにより、各能動素子領域が隣接する二つのトレンチキャパシタにまたがるように複数の能動素子領域を区画する工程と、
前記各能動素子領域に二つずつのトランジスタをそのソース、ドレイン拡散層の一方を共有し、他方が前記不純物拡散層を介して前記コンタクト層に接続されるように、且つゲート電極が一方向に連続するワード線となるように形成する工程と、

- 前記ソース、ドレイン拡散層の一方に接続されて前記ワード線と交差するよう
にビット線を形成する工程と
を有する半導体記憶装置の製造方法。
16. 半導体基板に、キャパシタノード層がキャップ絶縁膜で覆われた状
態で且つそのキャップ絶縁膜表面が前記半導体基板の表面より下に位置するよう
に、複数のトレンチキャパシタを一定ピッチで配列形成する工程と、
前記トレンチキャパシタが形成された半導体基板上に半導体層をエピタキシャル
成長させる工程と、
前記半導体層に前記トレンチキャパシタのキャパシタノード層に達するコンタクト層を埋め込み形成する工程と、
前記半導体層に素子分離絶縁膜を形成することにより、各能動素子領域が隣接
する二つのトレンチキャパシタにまたがるように複数の能動素子領域を区画する
工程と、
前記各能動素子領域に二つずつのトランジスタをそのソース、ドレイン拡散層
の一方を共有し、他方が前記トレンチキャパシタ領域上に位置するように、且つ
ゲート電極が一方向に連続するワード線となるように形成する工程と、
前記ソース、ドレイン拡散層の他方を対応する前記コンタクト層に接続するた
めの表面接続導体を前記ワード線に自己整合された状態に形成する工程と、
前記ソース、ドレイン拡散層の一方に接続されて前記ワード線と交差するよう
にビット線を形成する工程と
を有する半導体記憶装置の製造方法。
17. 半導体基板に、キャパシタノード層がキャップ絶縁膜で覆われた状
態で複数のトレンチキャパシタを一定ピッチで配列形成する工程と、
前記トレンチキャパシタが形成された半導体基板上に基板分離用絶縁膜を介して
別の半導体基板を貼り合わせることにより第1の半導体層を形成する工程と、
前記第1の半導体層に前記キャパシタノード層に達するコンタクト層を埋め込
む工程と、
前記コンタクト層が埋め込まれた第1の半導体層上に第2の半導体層をエピタ
キシャル成長させる工程と、
前記第1及び第2の半導体層に素子分離絶縁膜を形成することにより、各能動
素子領域が隣接する二つのトレンチキャパシタにまたがるように複数の能動素子
領域を区画する工程と、
前記各能動素子領域に二つずつのトランジスタをそのソース、ドレイン拡散層
の一方を共有し、他方が前記コンタクト層の上面に接続されるように、且つゲー
ト電極が一方向に連続するワード線となるように形成する工程と、
前記ソース、ドレイン拡散層の一方に接続されて前記ワード線と交差するよう
にビット線を形成する工程と
を有する半導体記憶装置の製造方法。

ABSTRACT OF THE DISCLOSURE

半導体基板と、この半導体基板上に形成された第1導電型の第1半導体領域
と、この第1半導体領域上に形成され、第1導電型とは反対導電型である第2
導電型の第2半導体領域と、トレンチを有するトレンチキャパシタであって、
前記トレンチは前記第1半導体領域及び前記第2半導体領域を通過し、前記トレン
チキャパシタの上部が前記第2半導体領域の上表面上には到達しないように形成
され、前記トレンチ内には導電体トレンチフィルが形成されるトレンチキャパシ
タと、それぞれが前記第2半導体領域上に形成された一対のゲート電極であり、
それぞれが前記トレンチキャパシタの上方に位置している一対のゲート電極と、
前記一対のゲート電極のそれぞれを覆うように形成された一対の絶縁層と、前
記一対の絶縁層のそれぞれに自己整合するように前記一対の絶縁層相互間に形成
された導電層であり、この導電層の先端は前記第2半導体領域とは絶縁された状
態で前記第2半導体領域の内部に達しており、かつ前記導電層は前記トレンチキャ
パシタの前記導電体トレンチフィルと電気的に接続されている導電層と、前
記導電層を中心にして互いに対向するように配置され、それぞれが前記導電層と直接
に接触する。前記第2半導体領域内に形成された第1導電型の一対の第3半導体領域
であって、この一対の第3半導体領域のそれぞれは前記一対のゲート電極のそれぞれ
を有するトランジスタのソース、ドレインのいずれか一方を構成し、前記一対の第3
半導体領域のそれぞれは実質的に一様な深さで形成されている一対の第3半導体領域
とを有する半導体記憶装置。

Figure 1A

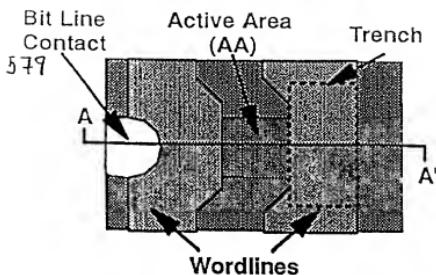


Figure 1B

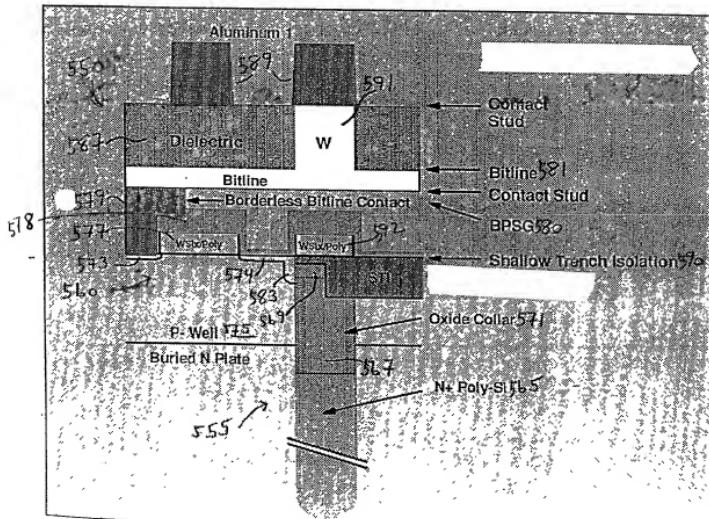


Figure 2A

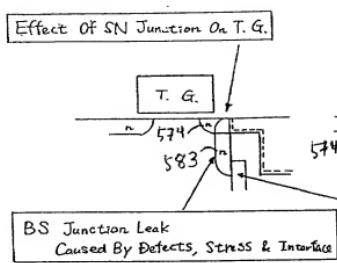
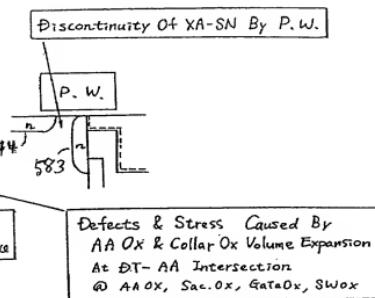


Figure 2B



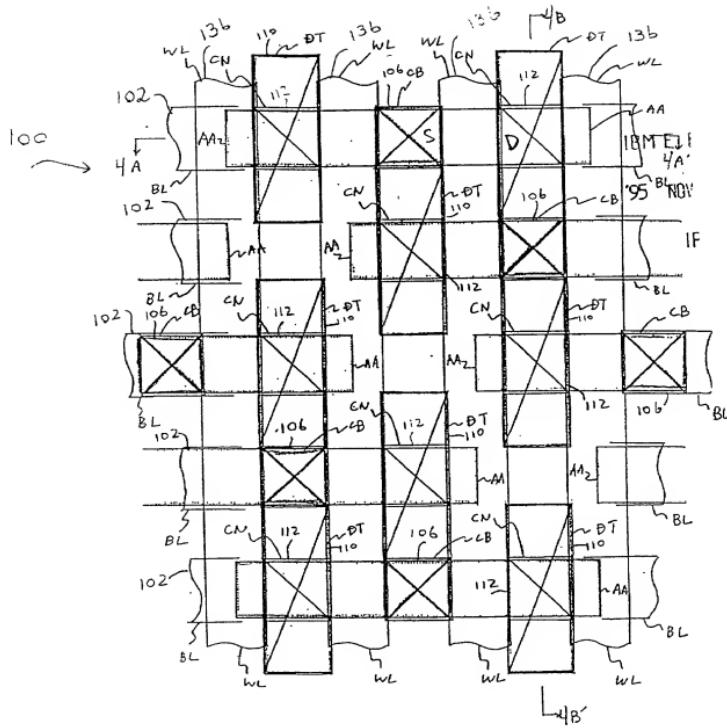


Figure 3

Figure 4A

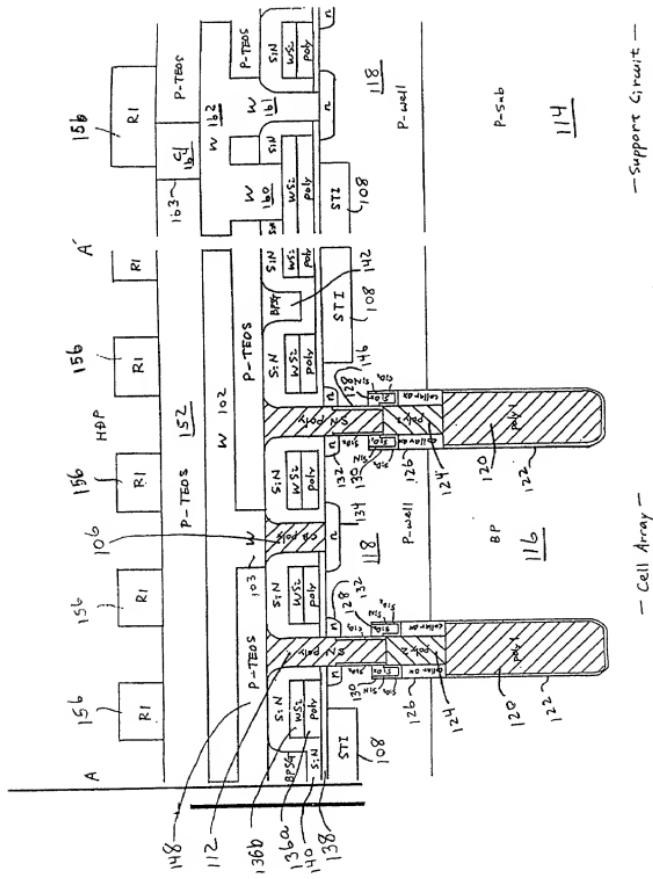
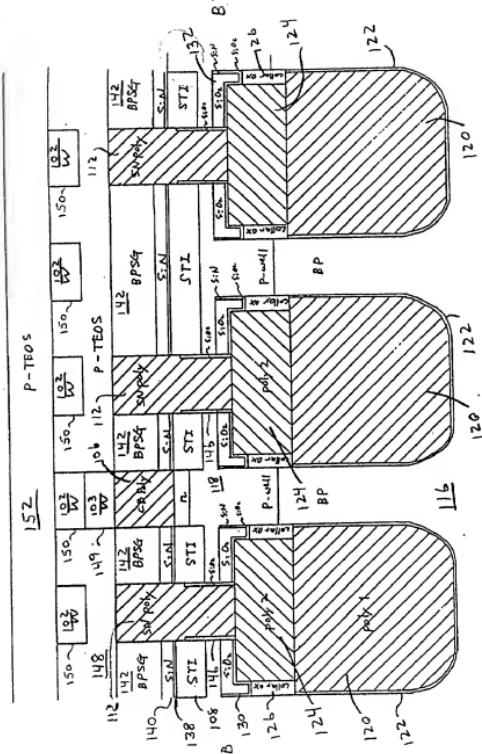


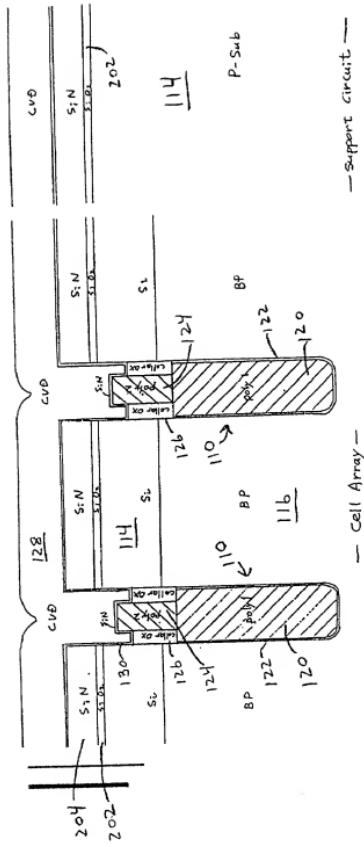
Figure 4B

HOP



卷之三

Figure 5A



Diode "Resistor" Structure

Figure 5B

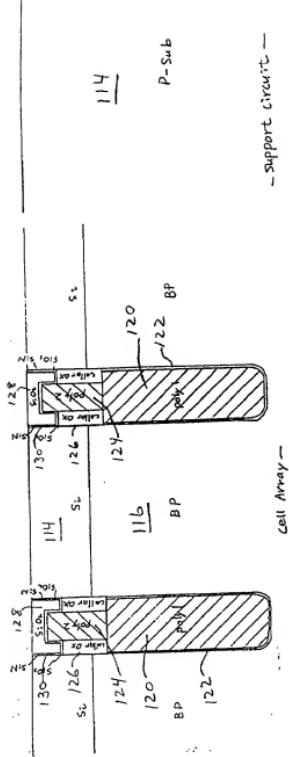
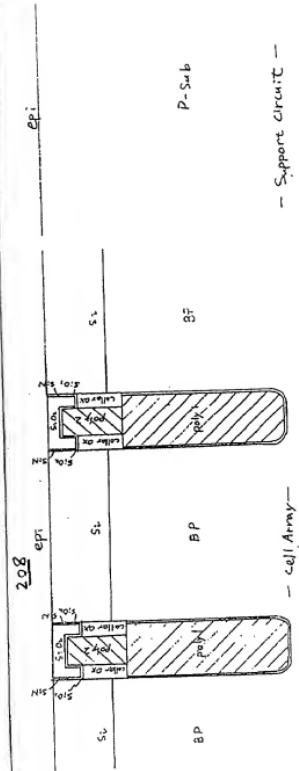
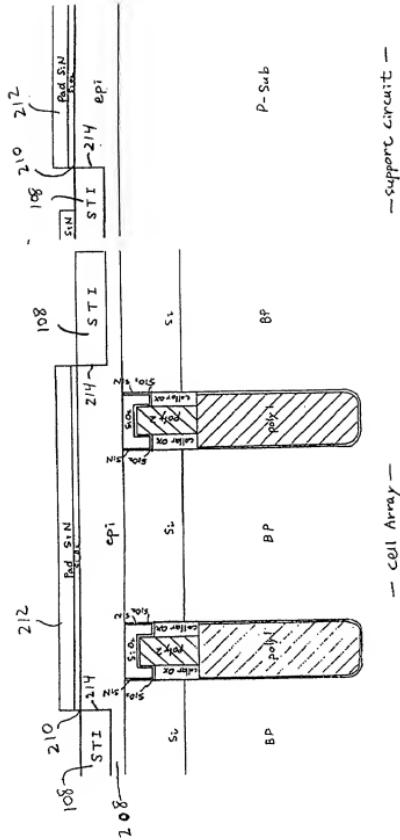


Figure 5C



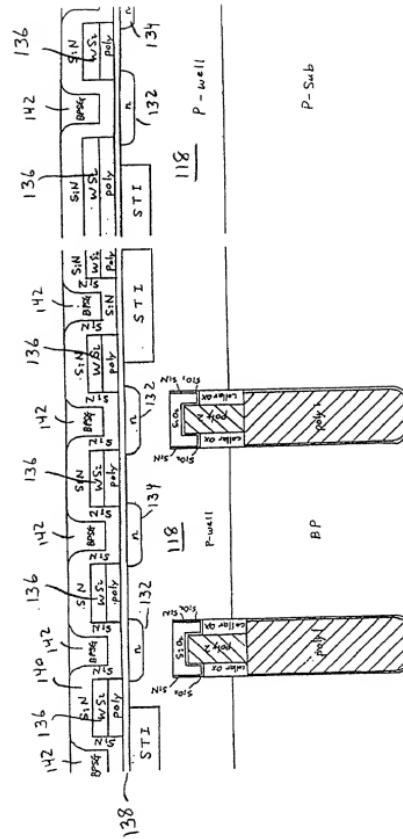
卷之三

Figure 5D



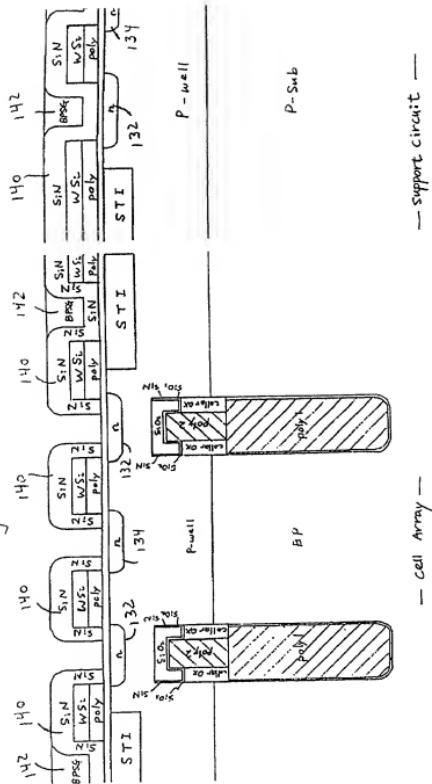
卷之三

Figure 5E



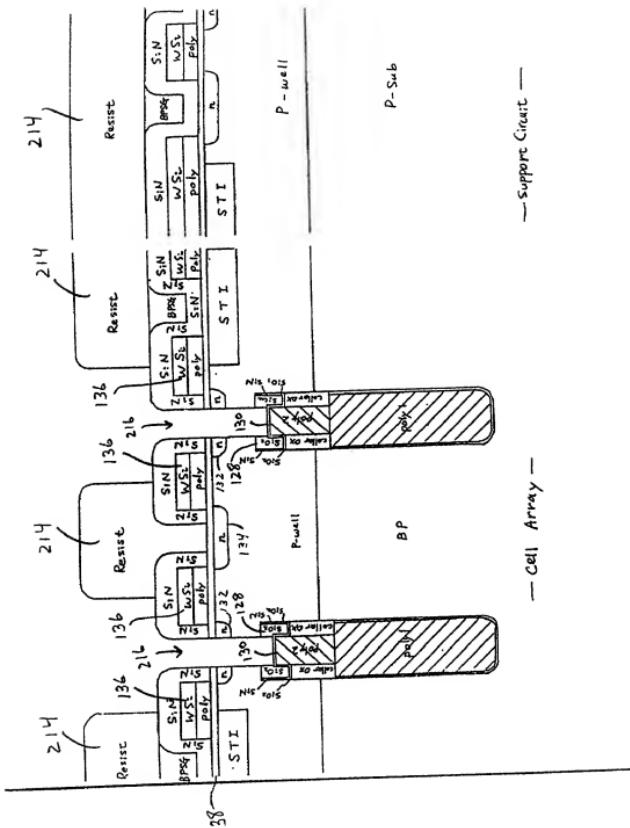
卷之三

Figure 5F



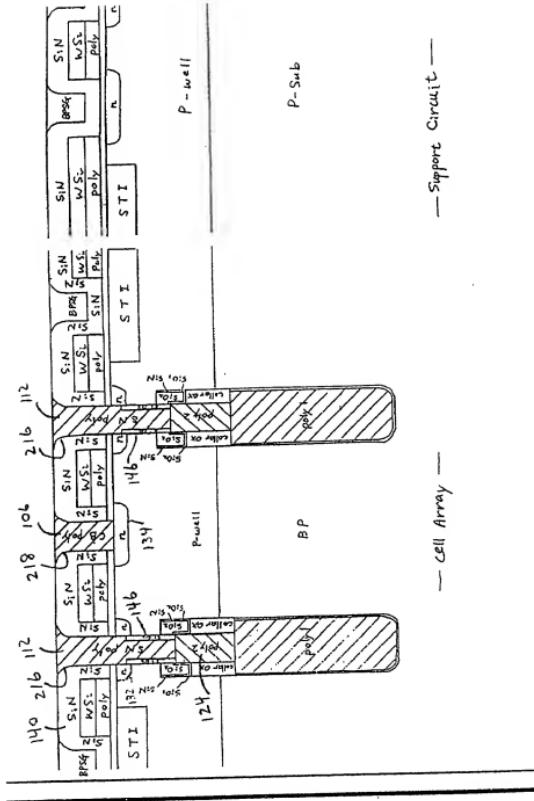
DIBOLIC " D " DEGENERATION

Figure 5-6



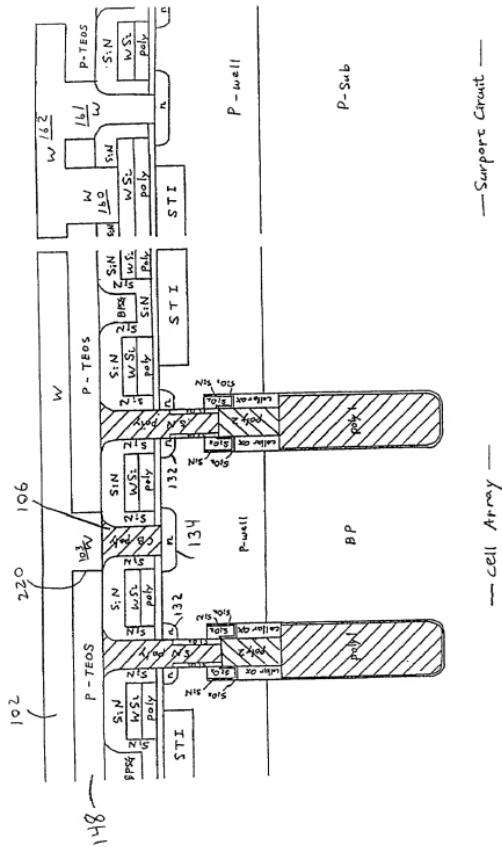
002350 - DISCUSSION

Figure 5H



0102TC60 " DESIGNATION

Figure 51



INTEGRATED CIRCUIT DESIGN

Figure 57

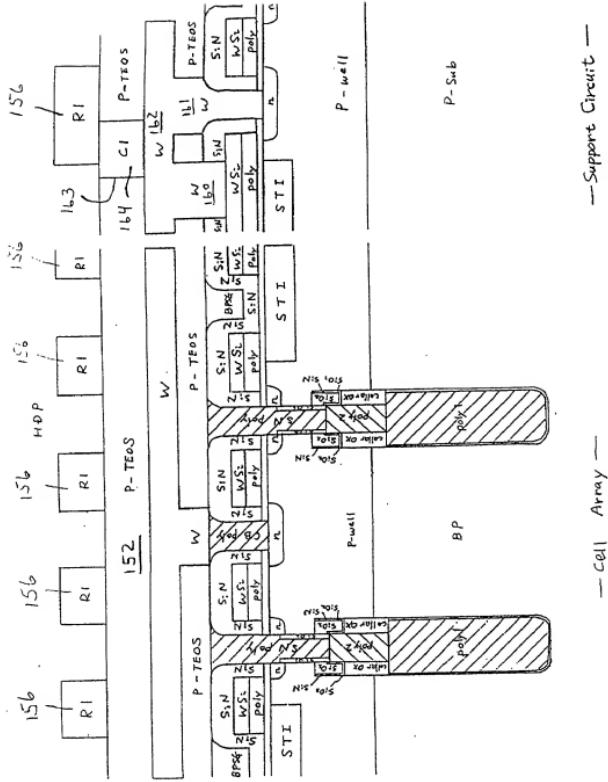
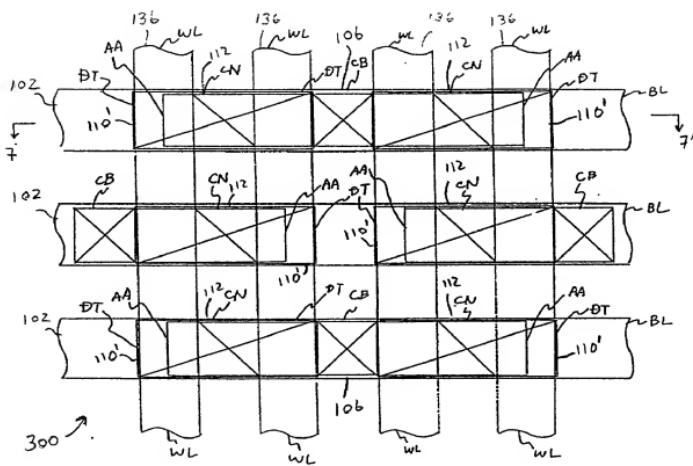


FIGURE 6



Device "Design"

Figure 7

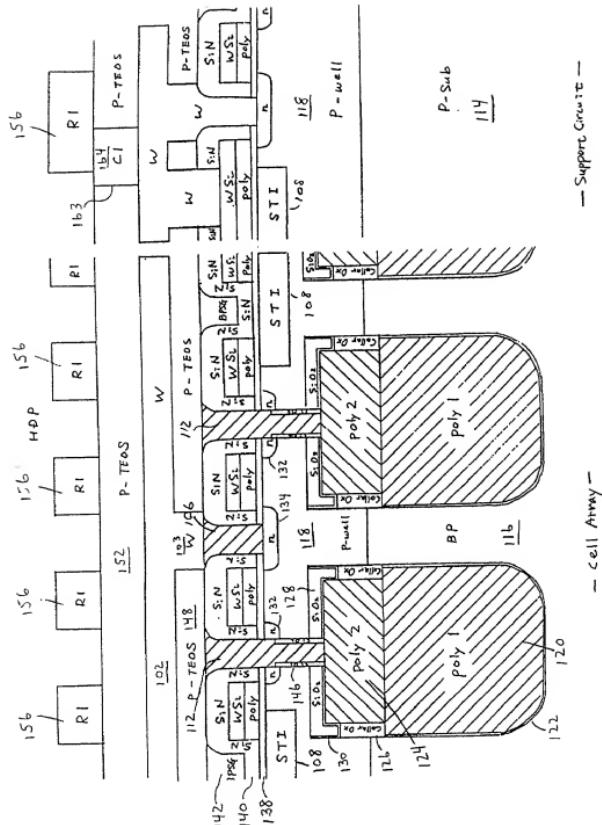


Figure 8

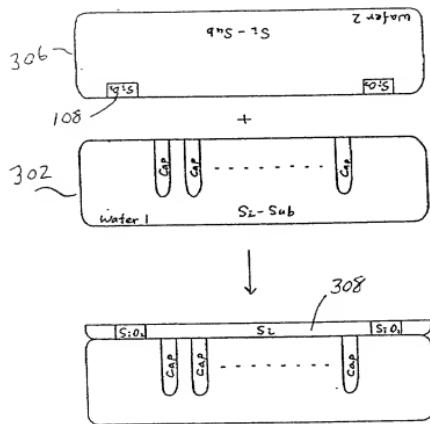


Figure 9A

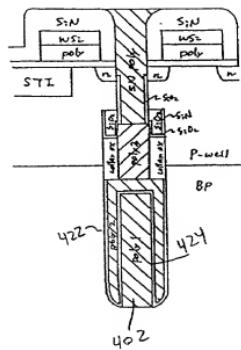
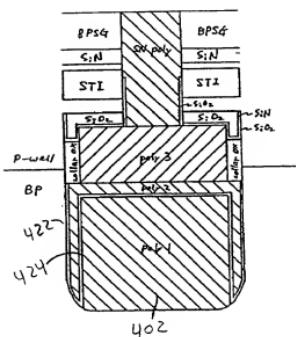


Figure 9B



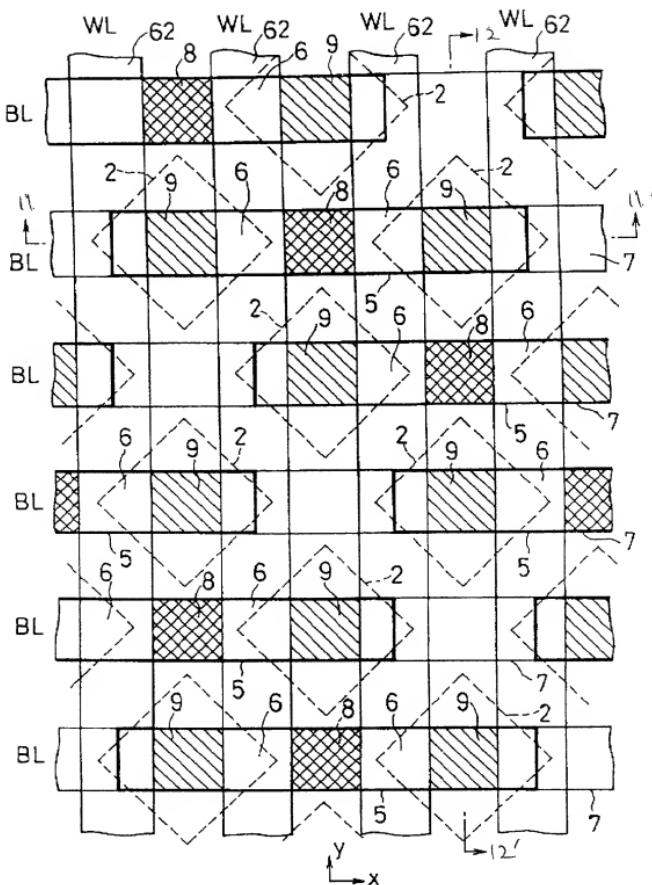


Figure 10

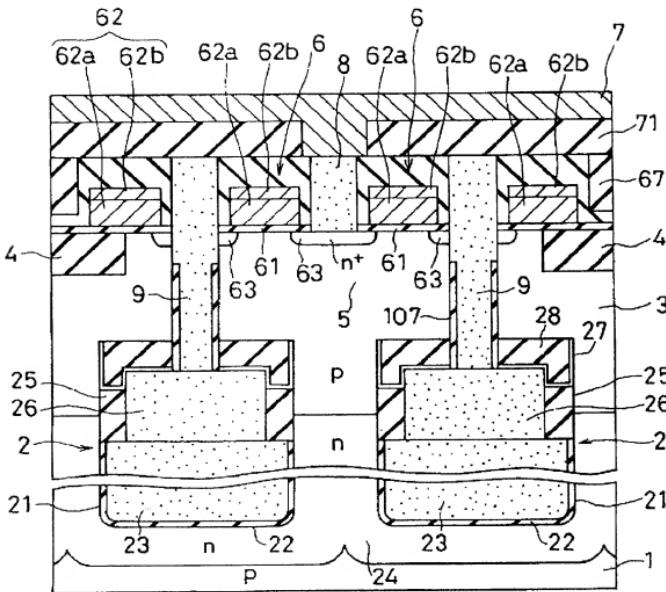


Figure 11

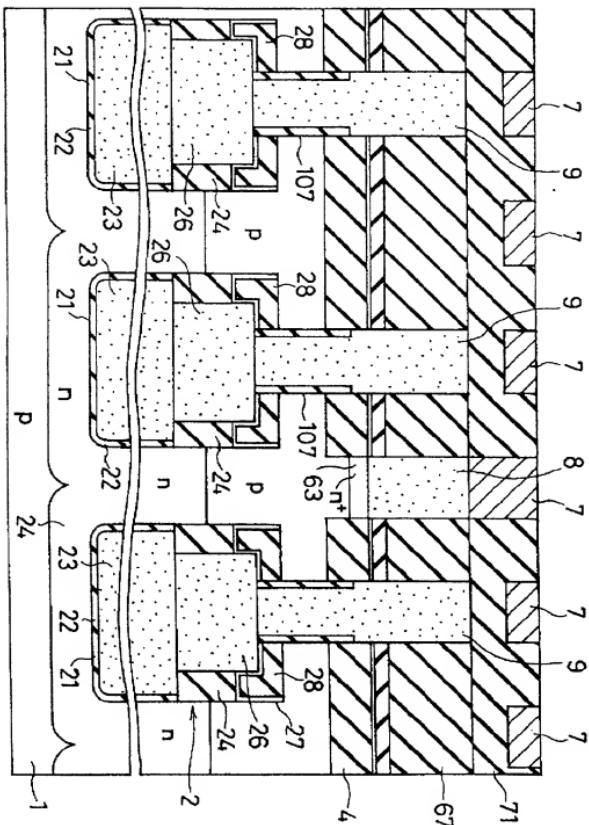


Figure 12

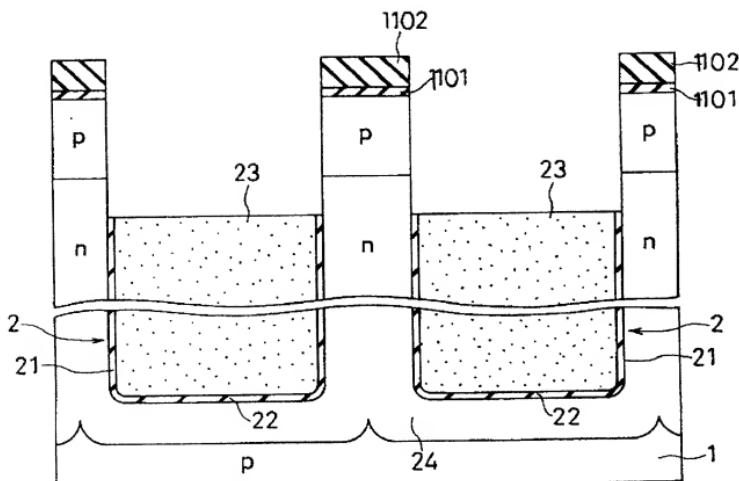


Figure 13A

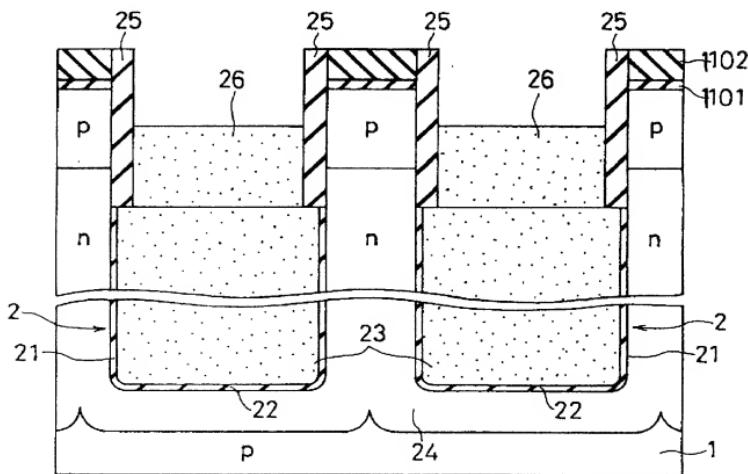


Figure 13B

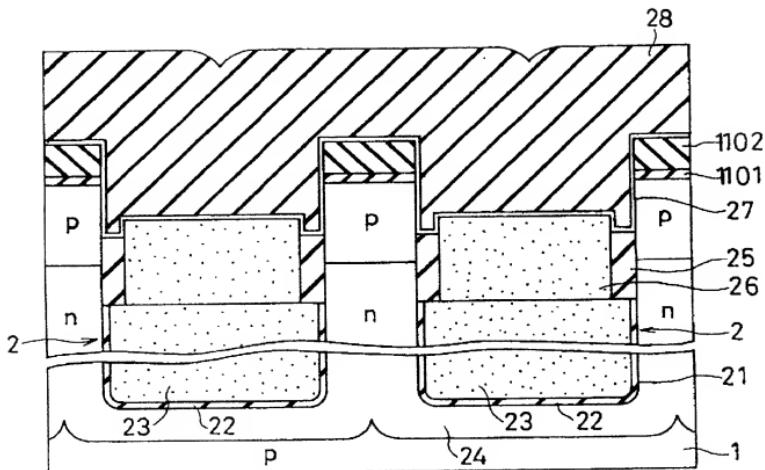


Figure 13C

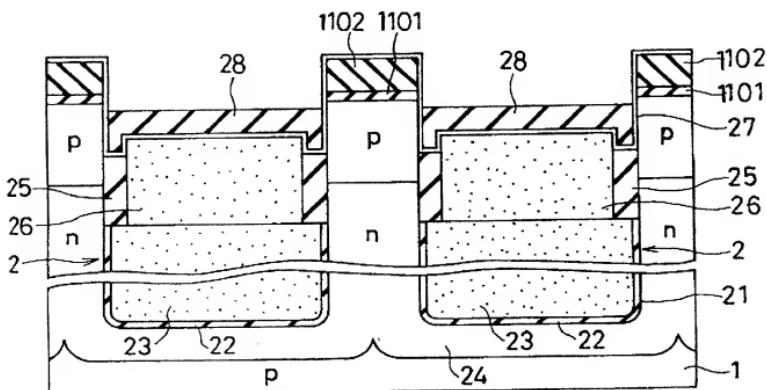


Figure 13D

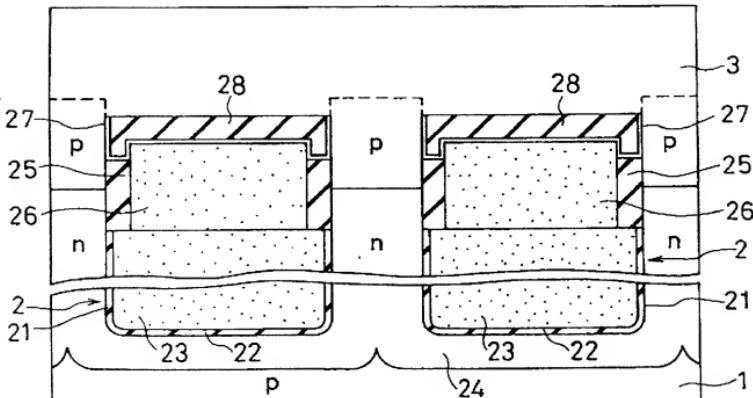


Figure 13E

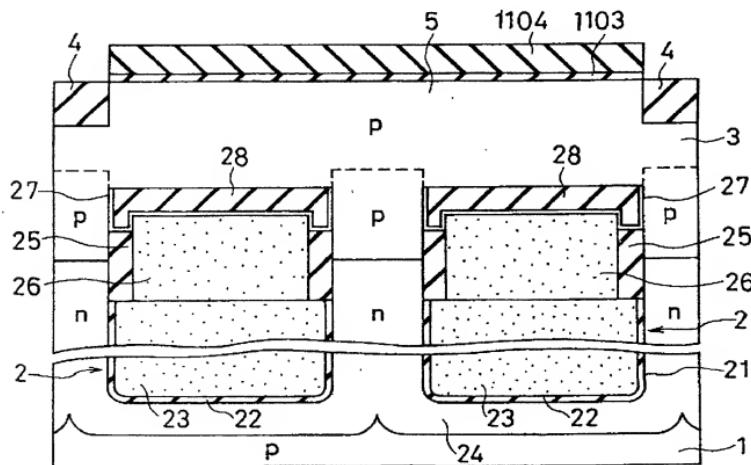


Figure 13F

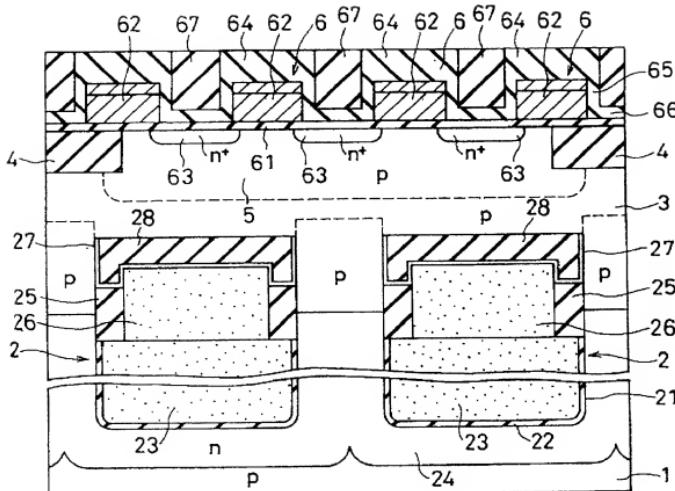


Figure 13G

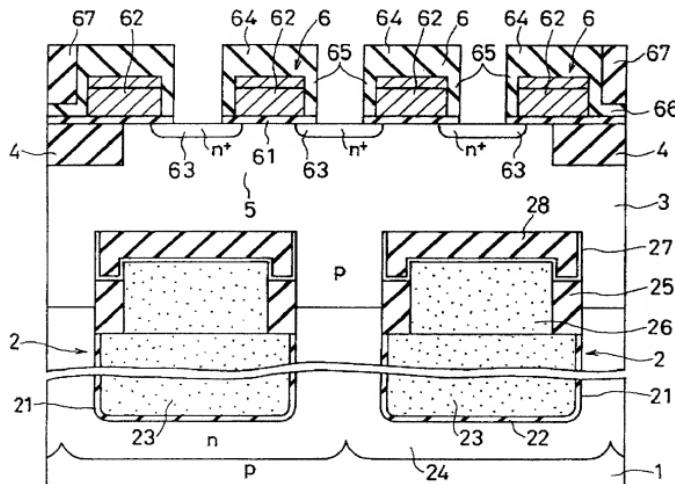


Figure 13H

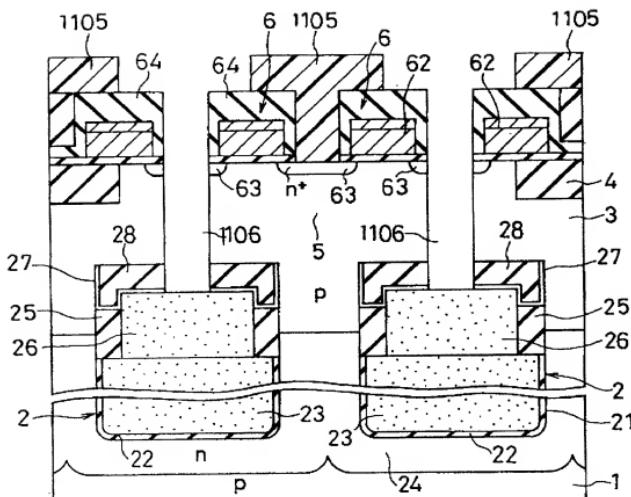


Figure 13I

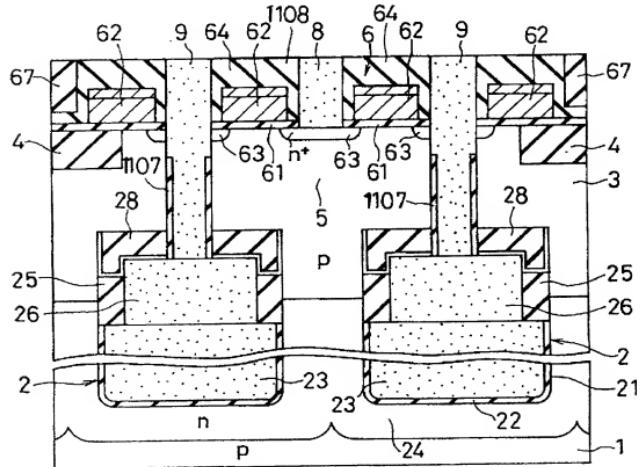


Figure 13J

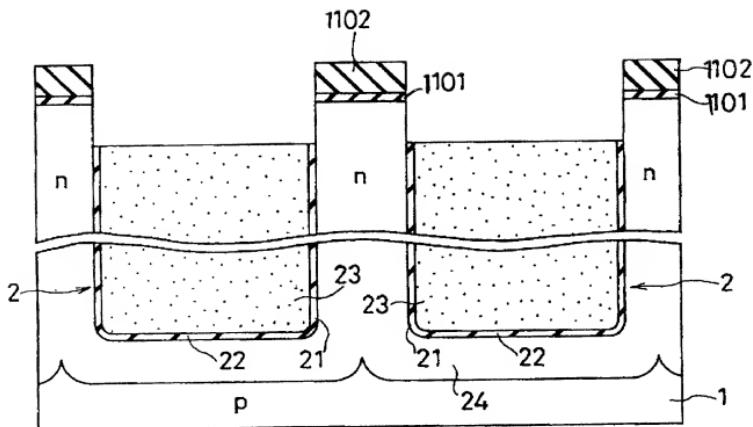


Figure 14A

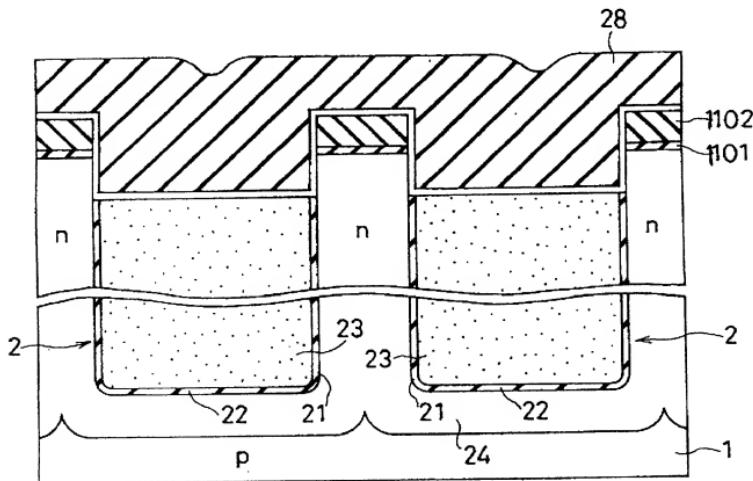


Figure 14B

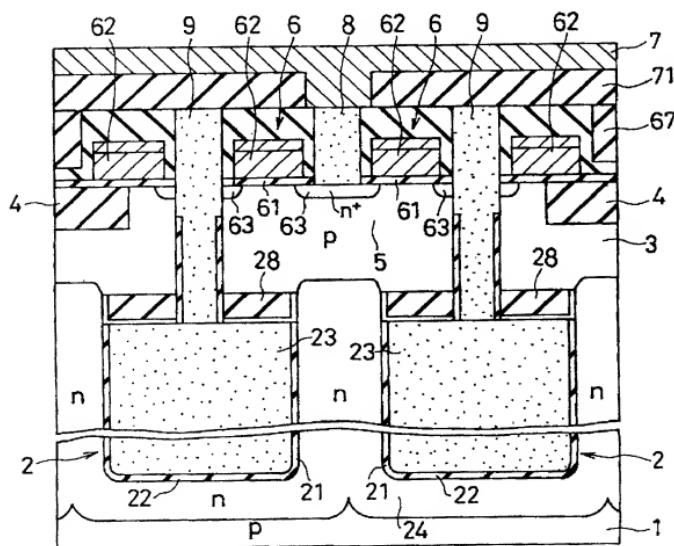
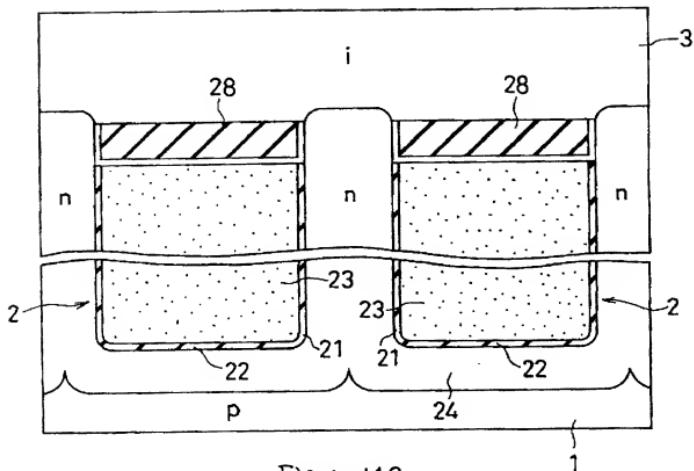


Figure 14D

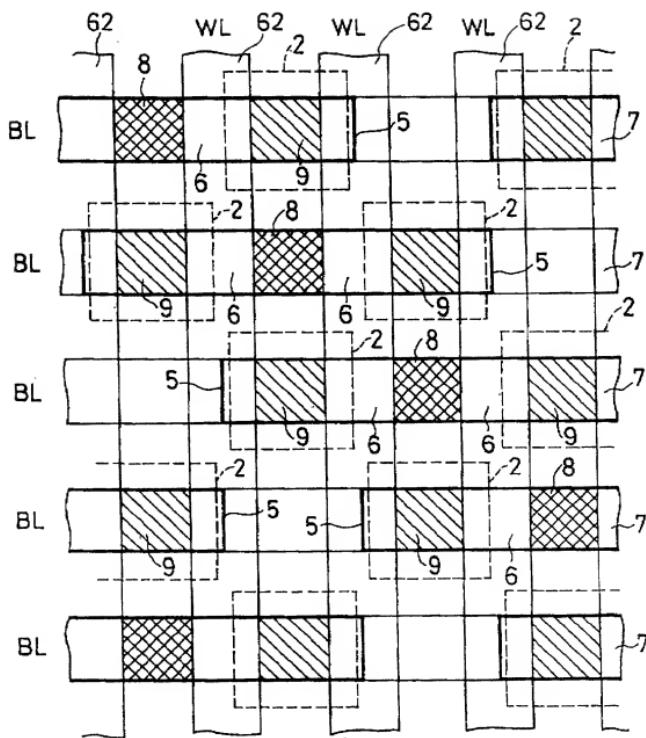


Figure 15

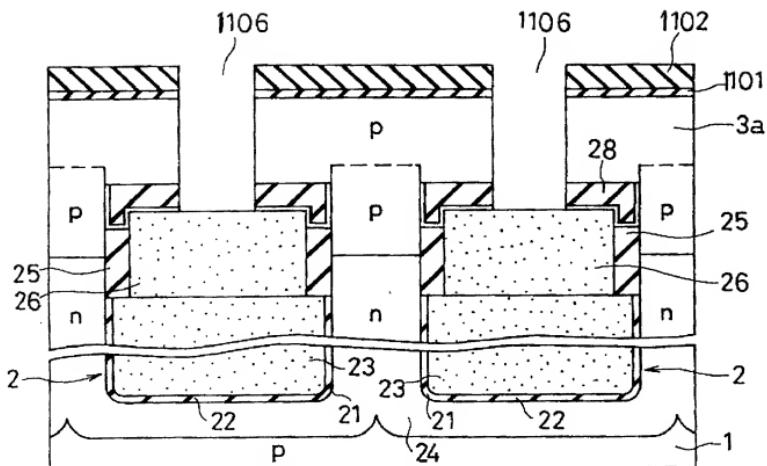


Figure 16A

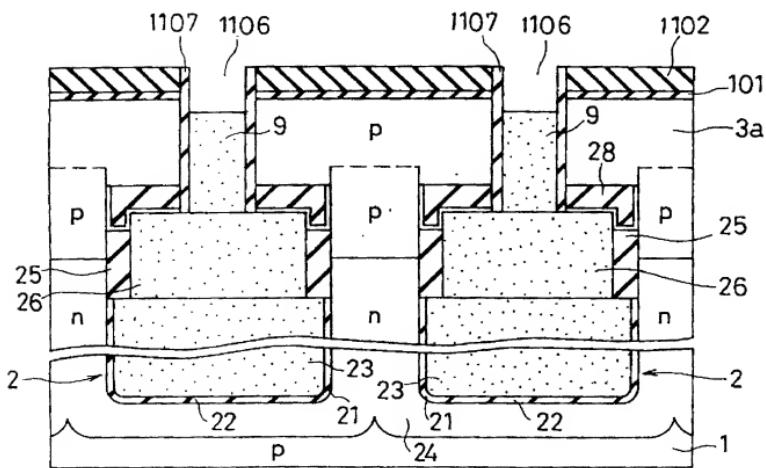


Figure 16B

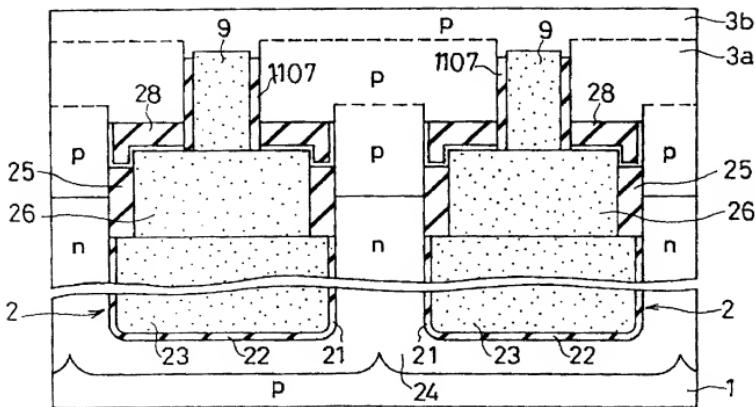


Figure 1GC

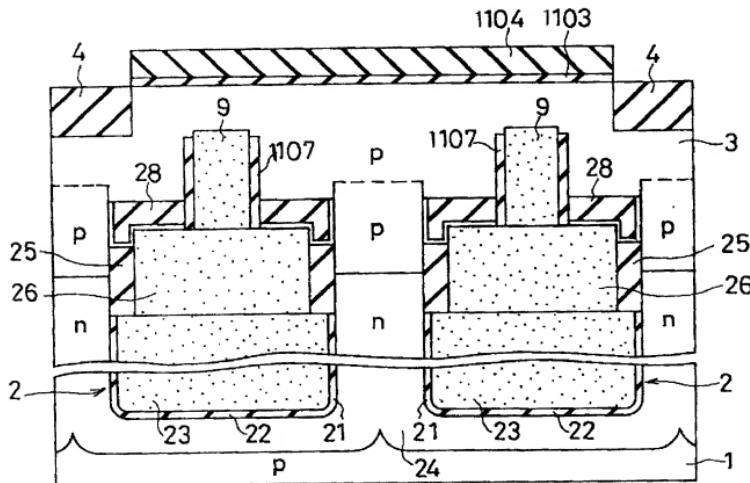


Figure 16-D

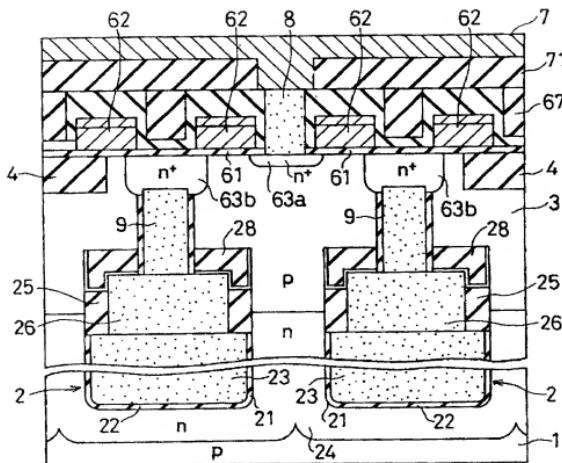


Figure 16E

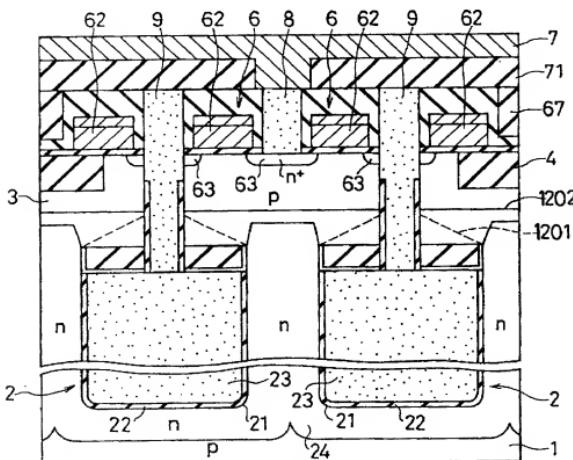


Figure 17

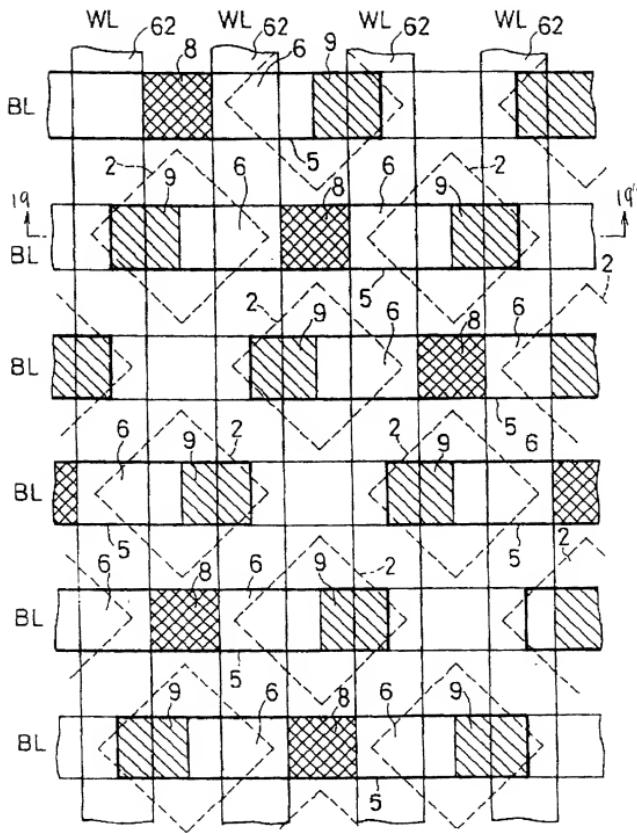
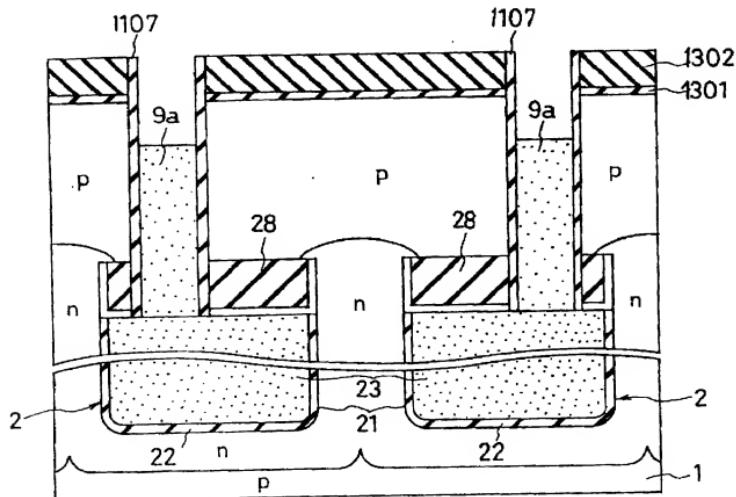
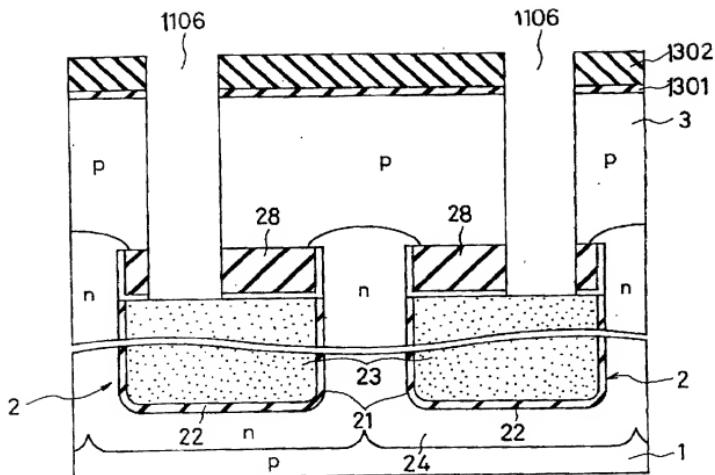


Figure 18



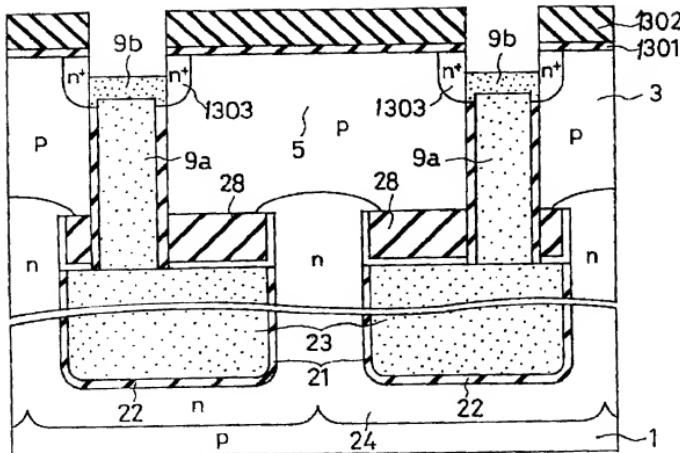


Figure 19c

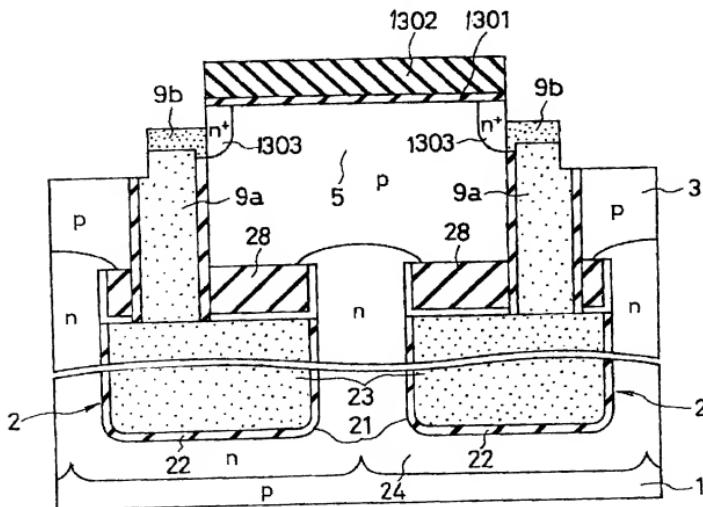


Figure 19-D

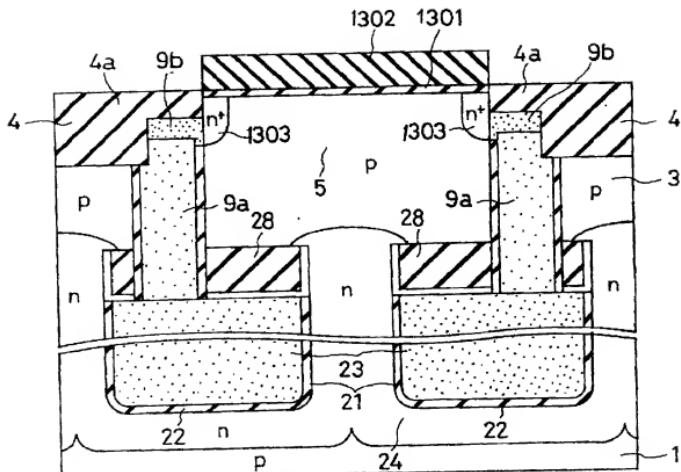


Figure 19E

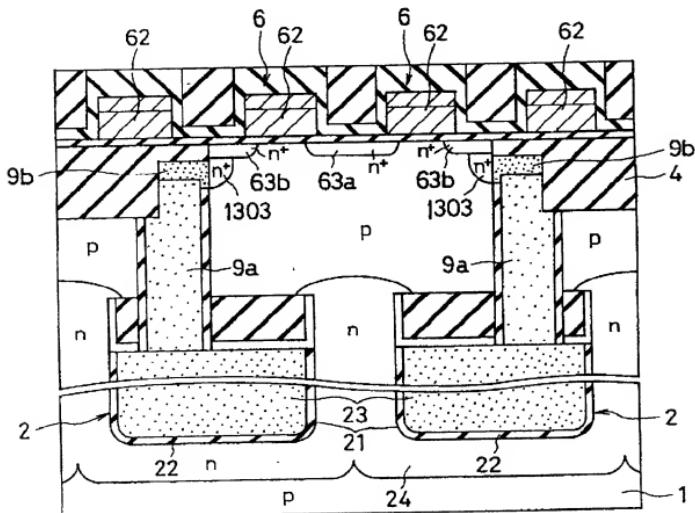


Figure 19F

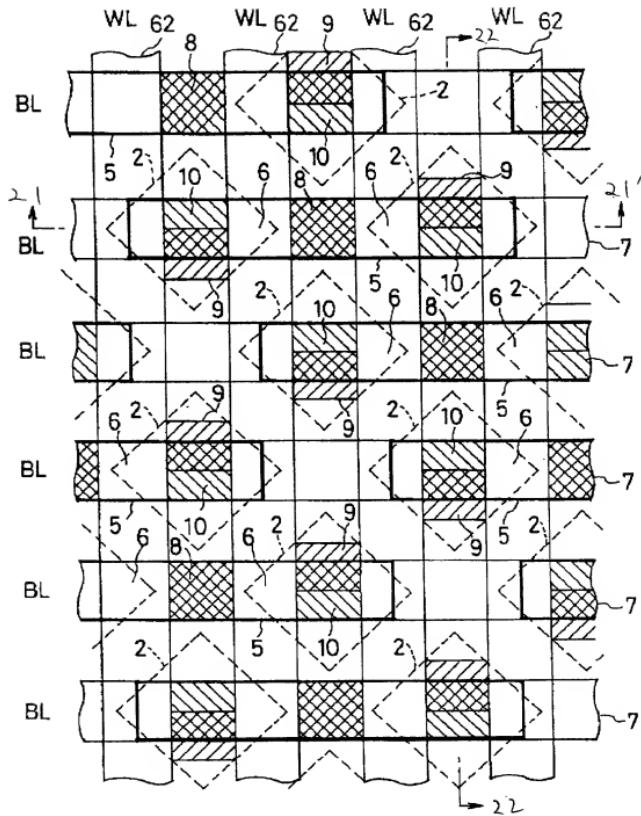


Figure 20

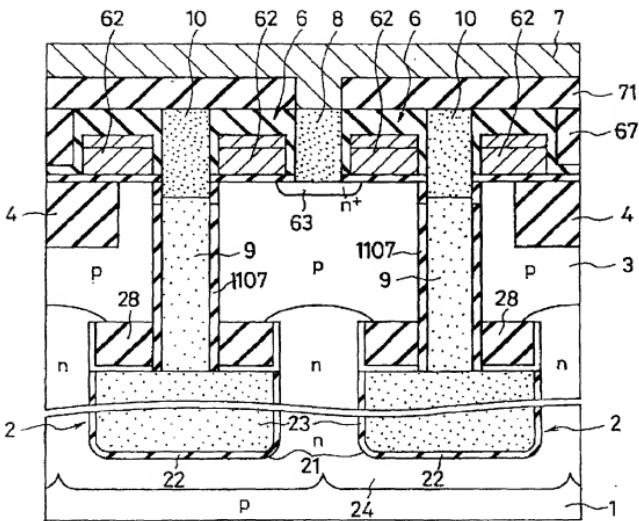


Figure 21

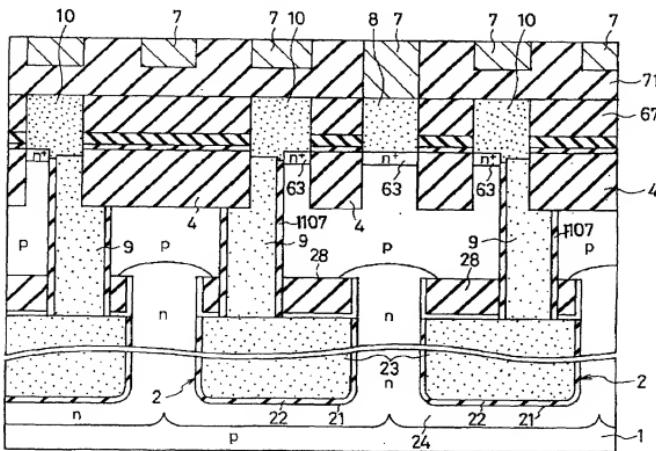


Figure 22

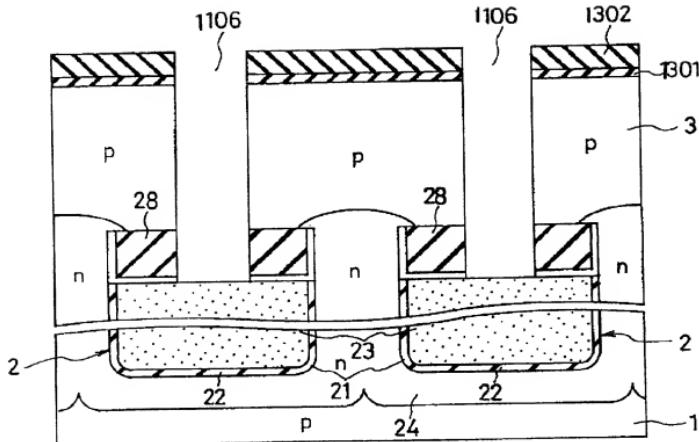


Figure 23A

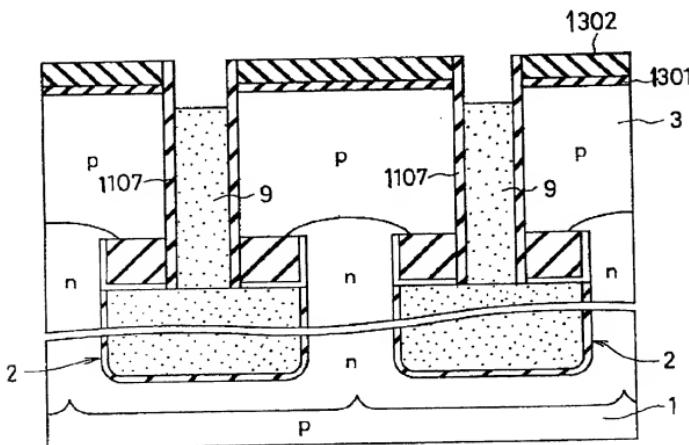


Figure 23B

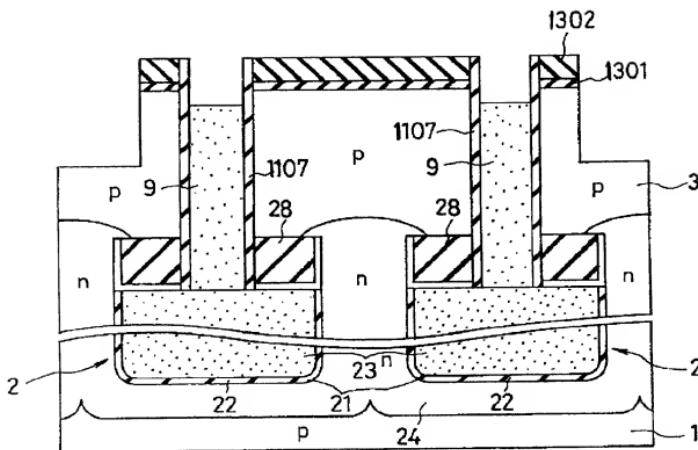


Figure 23C

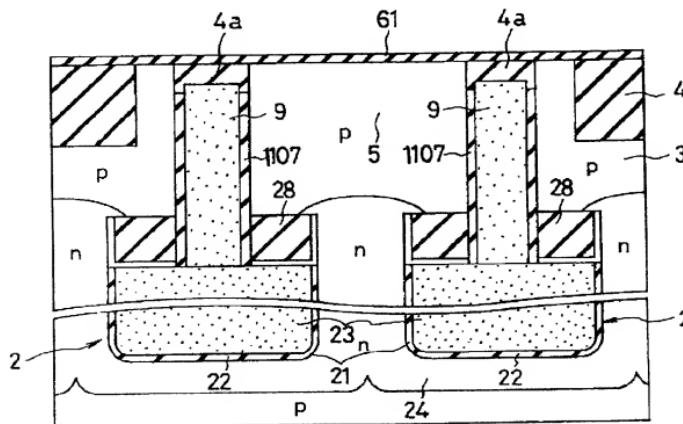


Figure 23D

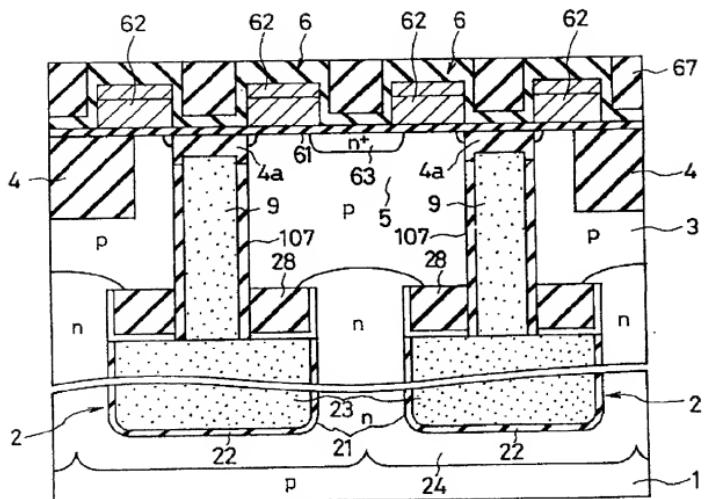


Figure 23E

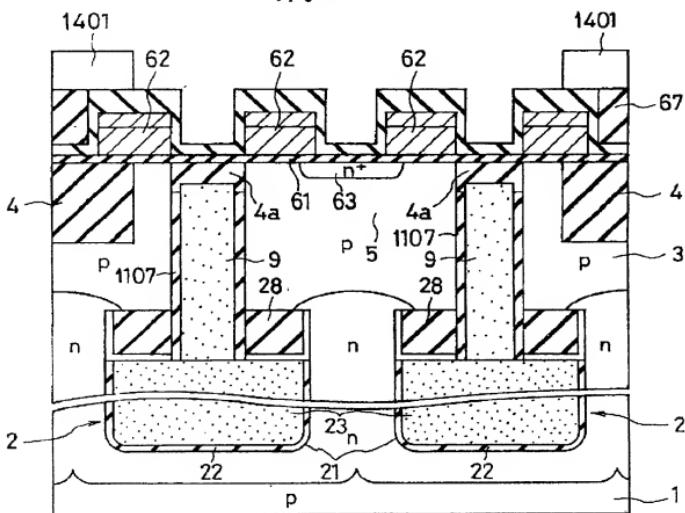


Figure 23F

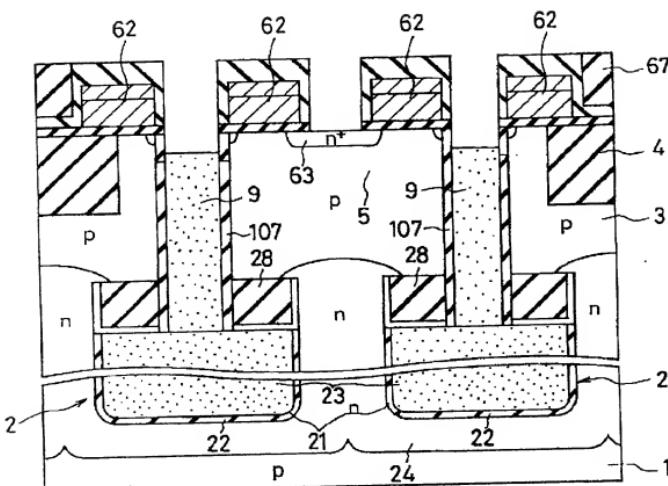


Figure 23G

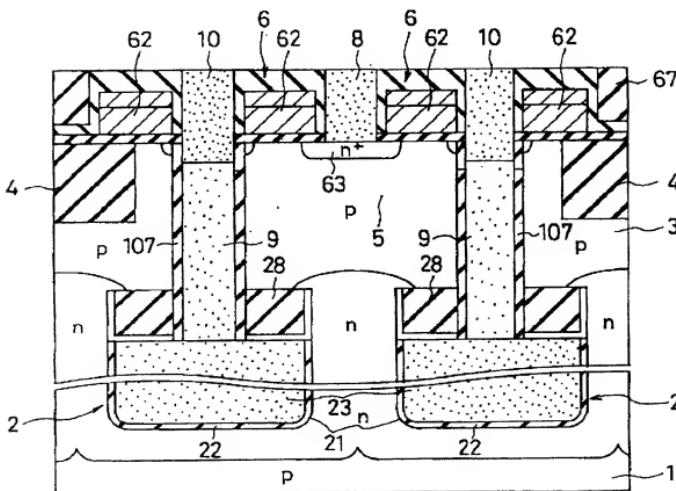


Figure 23H

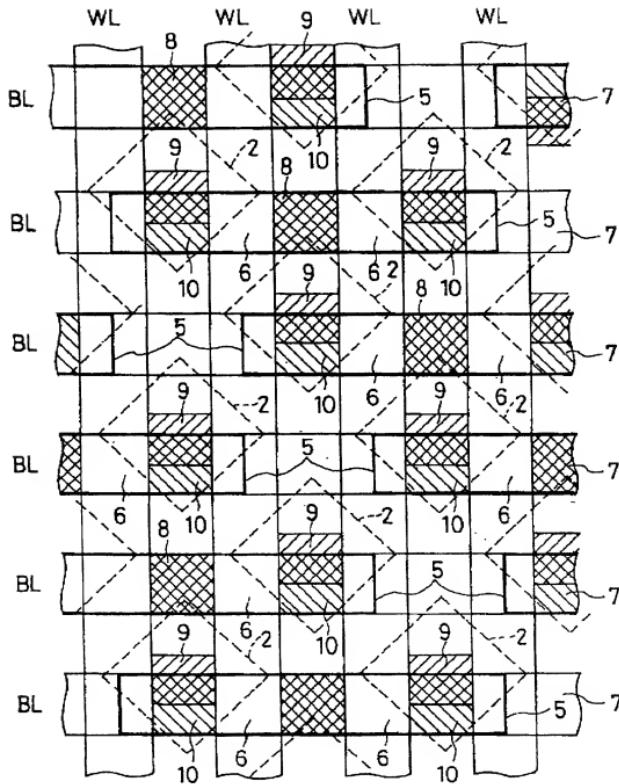


Figure 24

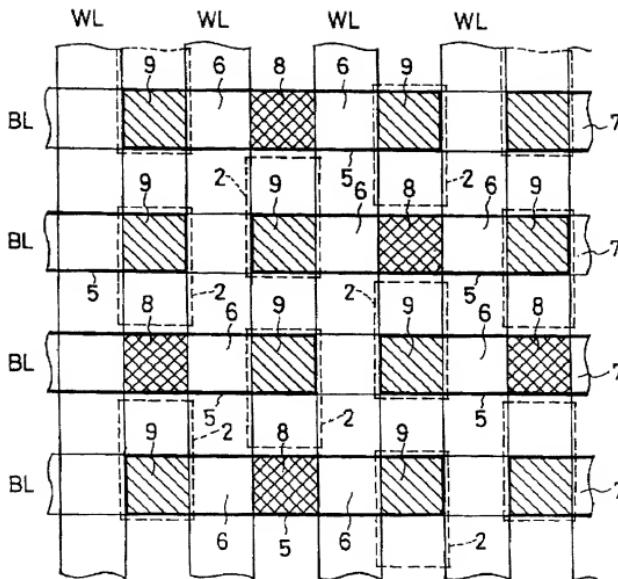


Figure 25

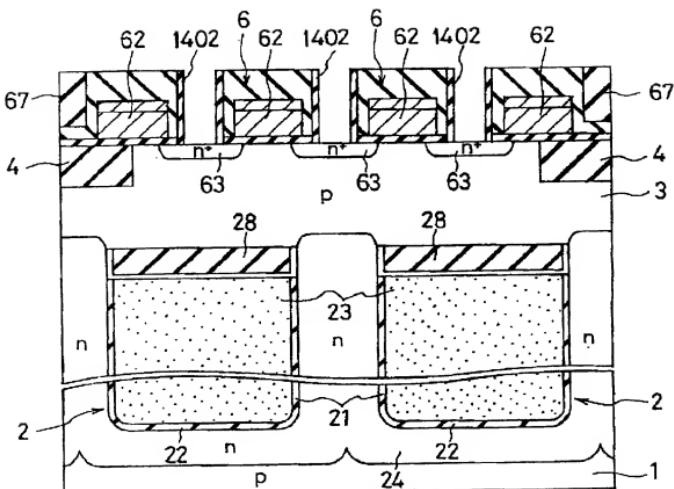


Figure 26A

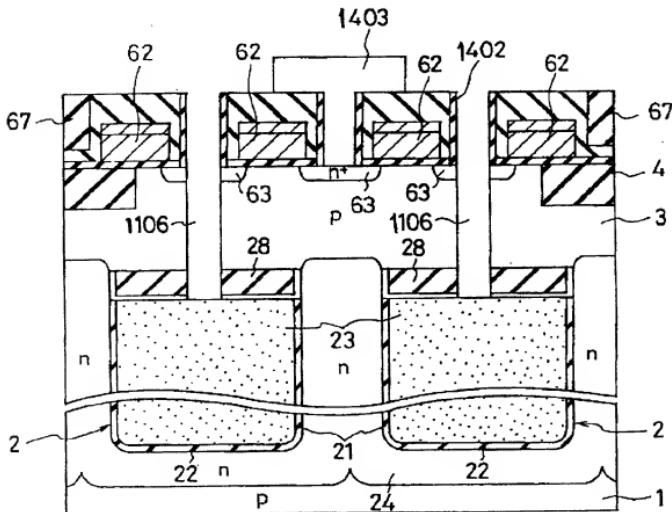


Figure 26B

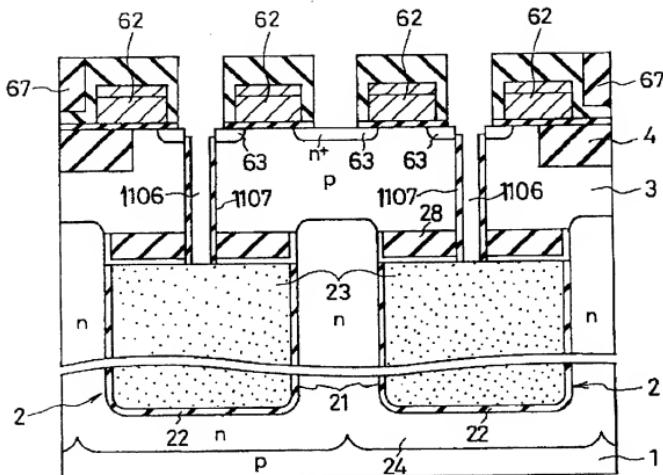


Figure 26C

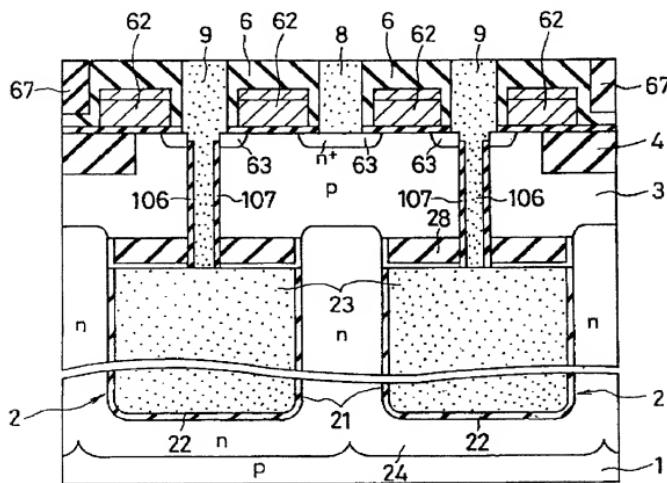


Figure 26D

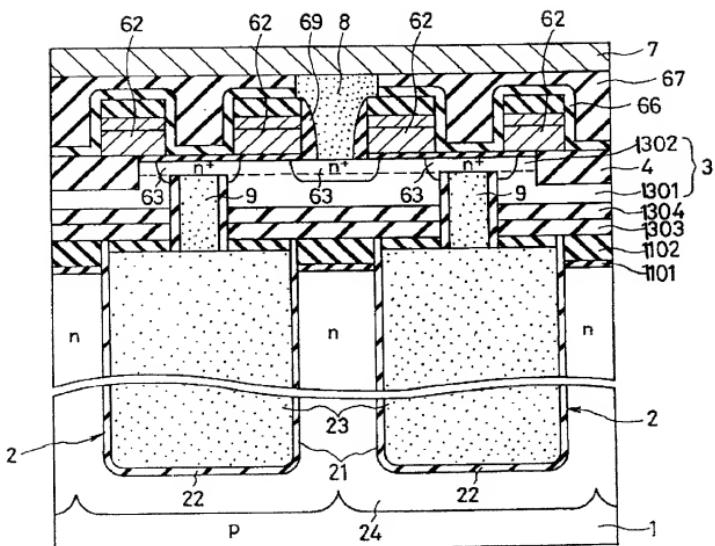


Figure 27

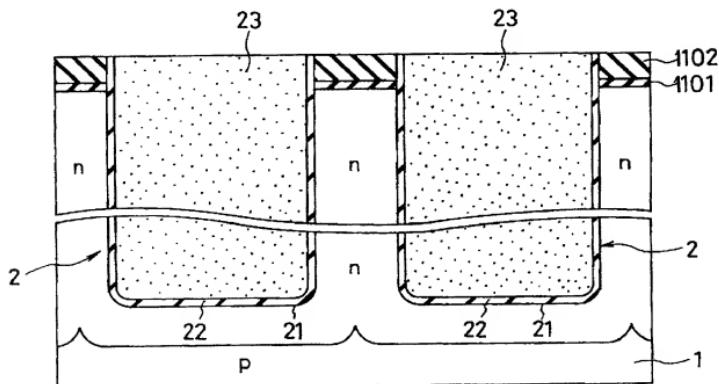
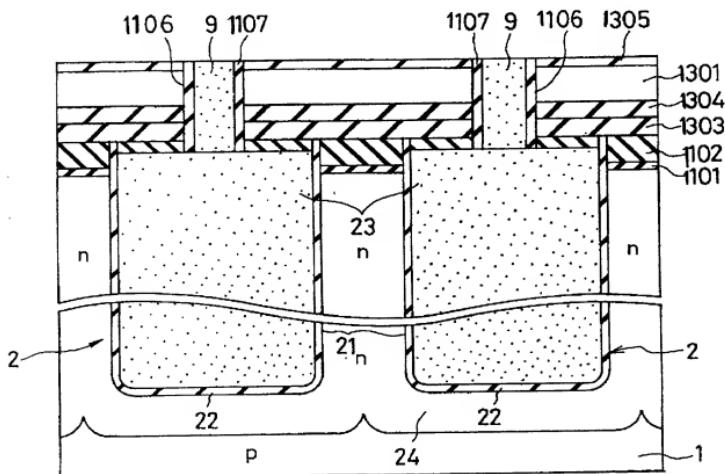
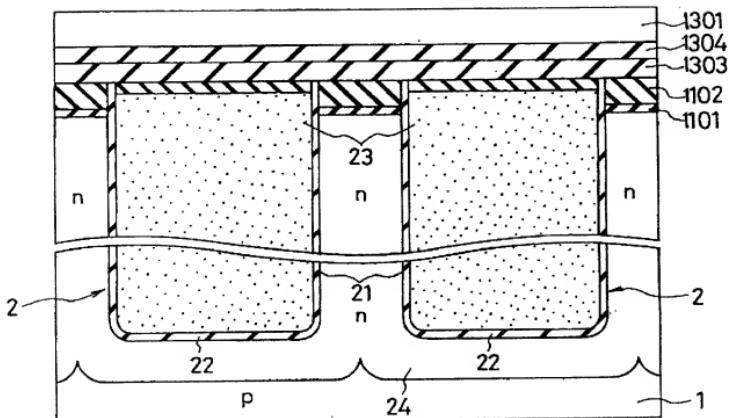


Figure 28A



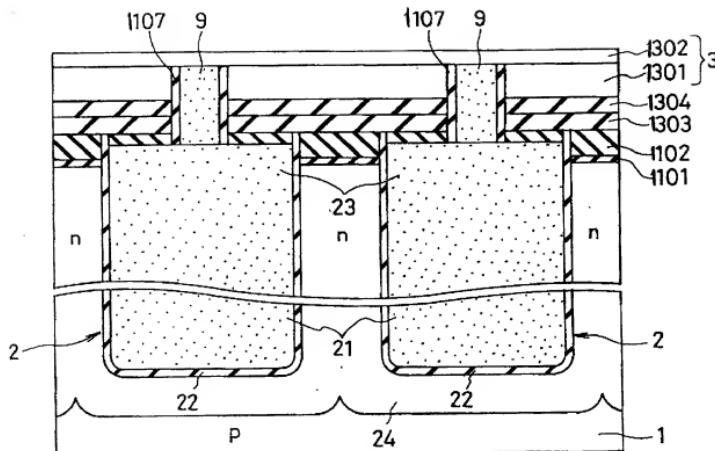


Figure 28D

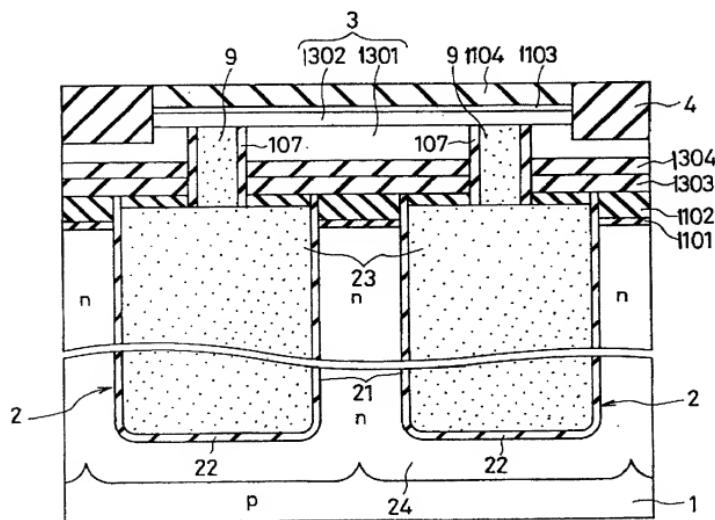


Figure 28E

09690394 - 091200

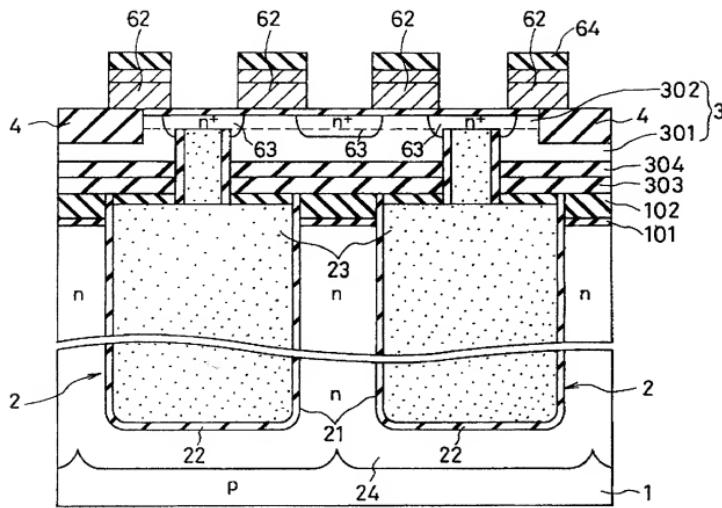


Figure 28F

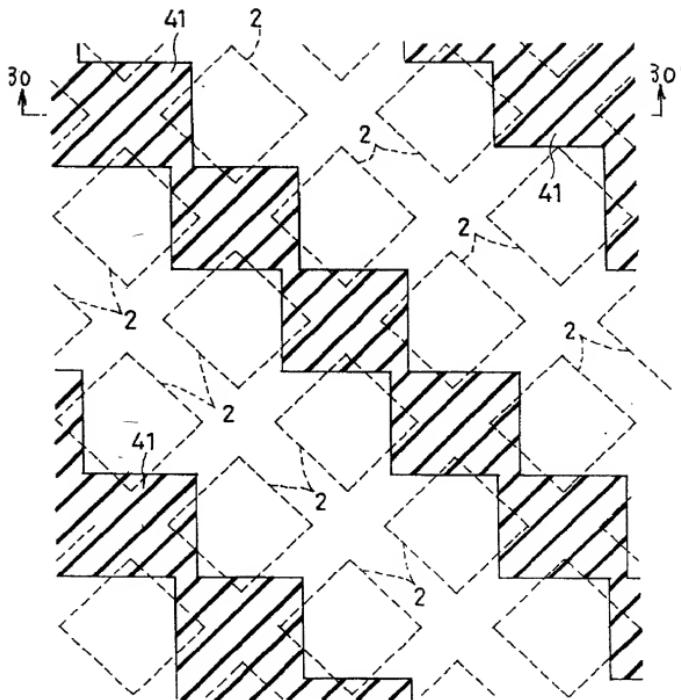


Figure 29

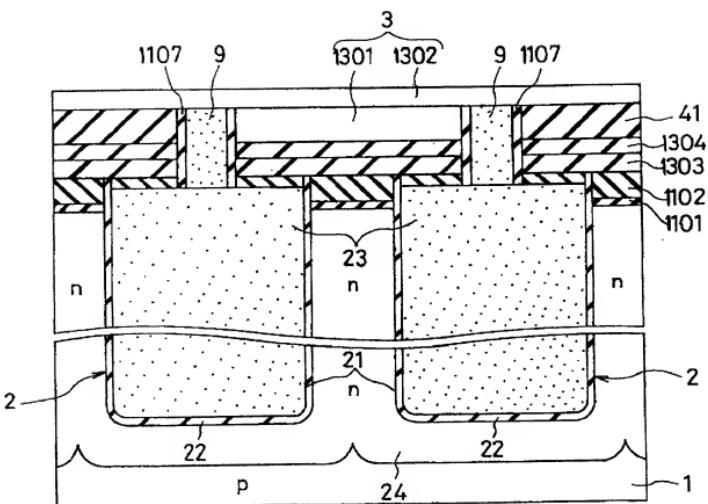


Figure 30

00966.0390 . 043200

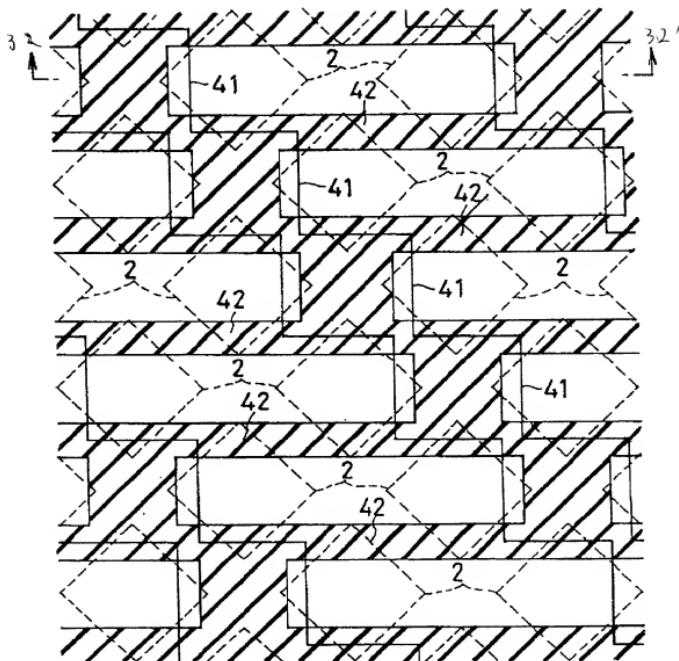


Figure 31

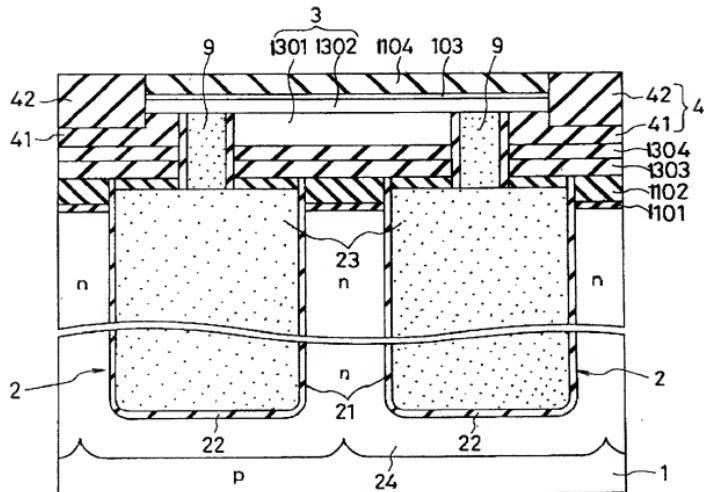


Figure 32

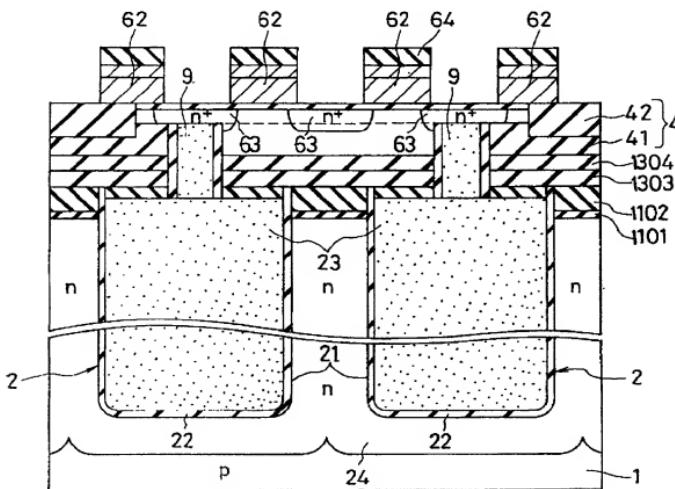


Figure 33